การจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์แบบประกอบตนเองบนแผ่นฐานลายตาราง แกลเลียมอาร์เซไนด์/อินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์

<mark>นาย มตินนท์</mark> ไมตรีบริรักษ์

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ALIGNMENT OF SELF-ASSEMBLED INAS QUANTUM DOTS GROWN ON GaAs/InGaAs/GaAs CROSS-HATCH TEMPLATES



สูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering Program in Electrical Engineering Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2010 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

โดย สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก การจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์แบบ ประกอบตนเองบนแผ่นฐานลายตารางแกลเลียมอาร์เซไนด์/ อินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์ นายมตินนท์ ไมตรีบริรักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล กาญจนซูชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตา<mark>มหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต</mark>

(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทย<mark>านิพน</mark>ธ์

<u>Ne ch</u>ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

ประวัน การณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล กาญจนซูชัย)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ)

มตินนท์ ไมตรีบริรักษ์ : การจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์แบบ ประกอบตนเองบนแผ่นฐานลายตารางแกลเลียมอาร์เซไนด์/อินเดียมแกลเลียมอาร์เซ ในด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์. (ALIGNMENT OF SELF-ASSEMBLED InAs QUANTUM DOTS GROWN ON GaAs/InGaAs/GaAs CROSS-HATCH TEMPLATES) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล กาญจน ชูชัย, 71 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบบนี้รายงานผลการศึกษาการจัดเรียง InAs ควอนตัมคอตบนแผ่นฐาน GaAs/In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs โดยทั่วไป InAs ควอนตัมดอตที่ประกอบตนเองบนแผ่นฐานลายตาราง ู่ In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs จ<mark>ะจัดเรียงตัวเป็นเส้นยาวในทิศ [110] และ [</mark>1-10] ตามลักษณะของผิวหน้าลาย ิตารางที่เกิดขึ้น การกล<mark>บทับชั้นลายตารางด้วยชั้น GaAs spacer</mark> ที่หนา 50-250 nm กลายเป็น GaAs/In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ส่งผลให้ผิวหน้ากลายเป็นแถบกว้างในทิศ [110] และเส้นยาวในทิศ [1-10] ความกว้างแถบในที่ศ [110] แปร<mark>ตามความหนาของชั้น</mark> GaAs spacer แถบที่กว้างขึ้นเป็นผล ้งากความสูงต่ำของพื้นผิวที่เ<mark>กิดงากการเลื่อนระนาบผลึกโดย</mark> Misfit dislocation ซึ่ง Misfit dislocation ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปเมื่<mark>อความหนาข</mark>องชั้<mark>น G</mark>aAs ด้านบนเพิ่มขึ้น การปลูกควอนตัม ดอตลงบนผิวหน้าดังกล่าวส่งผลให้<mark>ควอนต้มดอตเรียงตัว</mark>กันอย่างโดดเด่น ณ ขอบของแถบในทิศ [110] โดยจะสังเกตเห็นอย่างชัคเจนในชิ้นงานที่ชั้น GaAs หนา 250 nm เมื่อเทคนิคการปลูก ้ควอนตัมคอตเปลี่ยนจากแบบที่ชัตเตอร์ของ As₄ เปิดตลอดเวลาไปเป็นแบบ Migration enhance epitaxy (MEE) ซึ่งชัตเตอร์ของธาตุกลุ่ม III และ V สลับกันเปิค-ปิค ผลปรากฏว่าการจัดเรียงควอนตัม ้คอตเกิดการสลับทิศ จากที่เรียงตัวกันโคคเค่น ณ ขอบของเส้นแถบในทิศ [110] ไปเป็นเรียงตัวกันบน เส้นยาวในทิศ [1-10] ผลดังกล่าวเกิดจากความไม่เท่ากันของพื้นผิวในทิศ [110] และ [1-10] และ ความแตกต่างกันของอิสรภาพในการเคลื่อนที่ของอะตอม In จากเทคนิคการปลูกทั้งสองวิธี การ . เปล่งแสงของชิ้นงานเกิดขึ้นในย่านอินฟราเรคและด้วยความเข้มที่ไม่ด้อยไปกว่าควอนตัมคอตที่ปลูก บนแผ่นฐาน GaAs ชี้ให้เห็นว่า ควอนตัมคอตมีความสมบูรณ์เชิงผลึก อีกทั้ง dislocation ในชั้น InGaAs ไม่มีผลกระทบต่อสมบัติทางแสงของควอนตัมคอต นอกจากนี้แสงที่ได้จากควอนตัมคอตยัง เป็นแสง โพลาไรซ์ซึ่งเกิดจากการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของควอนตัมคอตบนชิ้นงาน

ภาควิชา....วิศวกรรมไฟฟ้า.....ลายมือชื่อนิสิต...*มด*ี่หน_ี ไ*มด*รัขริรักษ สาขาวิชา...วิศวกรรมไฟฟ้า.....ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ไม*้ได้ การจะเ* ปีการศึกษา......2553..... # # 5070598921 : MAJOR ELECTRICAL ENGINEERING KEYWORDS: MBE / SELF-ASSEMBLED / InAs QUANTUM DOTS / CROSS-HATCH / **DISLOCATION / GaAs SPACER / ALIGNMENT**

MATINON MAITREEBORIRAKS : ALIGNMENT OF SELF-ASSEMBLED InAs QUANTUM DOTS GROWN ON GaAs/InGaAs/GaAs CROSS-HATCH TEMPLATES. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. SONGPHOL

KANJANACHUCHAI Ph.D., 71 pp.

This thesis presents the results of the alignment of InAs quantum dots (QDs) on GaAs/In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs substrates. In general, self-assembled InAs quantum dot on the crosshatch In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs substrate align in long lines along [110] and [1-10] direction, which follows the characteristics of the surface. When adding 50-250 nm GaAs spacer layer on the top, resulting in GaAs/Ino 15 Gao 85 As/GaAs structure, the surface structure was changed. The new surface was composed of the wide stripes align along [110] direction and parallel lines along [1-10] direction. The width of the [110] stripes depends on the thickness of the GaAs spacer due to the surface undulation from the misfit dislocations which changed during the growth of the GaAs spacer layer. By using this new surface as template, the QDs were formed at the edge of the stripes, resulting in predominant QD alignment along the [110] direction. However, when the QD growth process changed from standard epitaxy where the As, shutter is always on to migrationenhance epitaxy (MEE) where the In and As cell shutters are alternately opened, the QD predominant alignment changed from [110] to [1-10] direction. This result was caused by the anisotropic surface between [110] and [1-10] direction, and the difference in In atoms migration. Photoluminescent (PL) measurement show that the sample emits the light in the infrared region, similar to InAs QDs grown on standard (100)-GaAs substrates, indicating that QDs have a good crystallinity and that dislocations from InGaAs layer do not adversely affect QD optical properties. The lights emitted from QDs also have the polarization property which is caused by QDs alignment.

Field of Study : ELECTRICAL ENGINEERING Advisor's Signature Academic Year : 2010

Department : _____ELECTRICAL ENGINEERING Student's Signature มีดีแนก ไม่ดรับวิรักษ์

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิอาจจะสำเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดเครื่องมือที่ใช้ในการ ทดลองวิจัย และขาดความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภายในในห้องปฏิบัติการวิจัยสารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทรงพล กาญจนซูชัย ที่สละเวลา อันมีค่าของท่าน คอยดูแล คอยกำกับ และให้คำปรึกษาอันมีประโยชน์ยิ่งแก่ข้าพเจ้าตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา ความช่วยเหลือหลัก ๆ ของผู้เขียนโดยมากได้จากท่าน จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่อาจจะสำเร็จไปได้โดยไม่มีท่าน

ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสอบ สำเร็จการศึกษา ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บัญญาแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อันตรเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ และดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ

ผู้เขียนขอขอบ<mark>พระคุณเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิจัยสารกึ่งตัวนำทุกท่านที่คอย</mark> ช่วยเหลือทางเทคนิคและทางด้านเครื่<mark>องมือในการทดลอ</mark>งต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียนขอขอบคุณรุ่นพี่ปริญญาเอกทุกคนที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือใน เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างดีตลอดมา รวมถึงต้องขอขอบคุณรุ่นน้องทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีที่ให้ กำลังใจ ความสุข และความสนุกสนานตลอดมา ผู้เขียนขอเก็บเรื่องราวที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันไว้เป็น ความทรงจำที่ดีตลอดไป

ผู้เขียนขอขอบพระคุณพี่ ๆ ห้องธุรการที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ คำปรึกษาในการดำเนินเรื่องการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษา

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดาและมารดา รวมถึงทุกคนในครอบครัวที่ได้ให้ การสนับสนุนผู้เขียนในทุก ๆ เรื่องอย่างดีมากมาโดยตลอด

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทยง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ
กิตติกรรมประกาศฉ
สารบัญช
สารบัญตารางญ
สารบัญภาพฏ
บทที่ 1 บทนำุ1
บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน
2.1 ควอนตัมดอ <mark>ต</mark> 7
2.2 การปลูกควอนตัมดอต
2.2.1 การปลูกควอนตัมดอตโดยวิธี Stanski-Krastranow
2.3 การกำหนดตำแหน่ <mark>ง</mark> ของควอนตัมดอต10
2.3.1 การใช้แม่พิมพ์บังคับให้เรียง (Force alignment template)10
2.3.1.1 ซับสเตรตที่มีลวดลายล่วงหน้า (Pre-patterned
substrate)10
2.3.1.2 ซับสเตรตดัชนีสูง (High index substrate)11
2.3.2 การจัดเรียงตนเองด้วยลวดลายวิศวกรรมความเครียด (Self-
alignment strain engineering pattern)
2.3.2.1 แม่พิมพ์ซุปเปอร์แลตทิซ (Superlattice templates)13
2.3.2.2 ลวดลายตาราง (Cross-hatch patterns):
InGaAs/GaAs14
2.3.2.2.1 ลักษณะโดยทั่วไป14
2.3.2.2.2 กลไกการเกิดลายตาราง
2.3.3.2.3 การปรับปรุงลายตารางของโครงสร้าง
In _{₀.15} Ga _{₀.85} As/GaAs โดยการใช้ GaAs
spacer layer19

บทที่ 3 รายละเอียดการทดลอง23
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง23
3.1.1 เอพิแทกซีแบบลำโมเลกุล (Molecular beam epitaxy) (MBE)23
3.1.1.1 หลักการทำงาน23
3.1.1.2 ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่อง MBE
3.1.1.3 ระบบสุญญากาศ26
3.1.2 In-situ measuring Equipment27
3. <mark>1.2.1 ระบบวัดความดัน</mark> 27
3.1.2.2 Reflection high-energy electron diffraction
(RHEED)
3.1.2.3 Quadruple mass spectrometer
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล
3.2.1 โฟโ <mark>ต</mark> ลูมิเนสเซนส์ (Photolumin <mark>esc</mark> ence)
3.2.2 กล้องจุ <mark>ลทรรศน์แรงอะตอม (A</mark> FM)30
3.3 การเตรียมชิ้นงาน31
3.4 การวัดเทียบอุณหภูมิ33
3.5 การวัดเทียบอัตราการปลูก34
3.5.1 การหาอัตราการปลูกของ GaAs34
3.5.2 การหาอัตราการปลูกของ InAs36
3.6 การปลูกชั้นผลึก
3.6.1 ชั้นบัฟเฟอร์
3.6.2 ชั้นลายตาราง36
3.6.3 ขั้น GaAs spacer37
3.6.4 ชั้นควอนต้มดอต
3.6.5 ชั้นกลบทับ40

หน้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	ชิ้นงานทั้งหมดที่ได้จากการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ชิ้นงานสำหรับ	
	ศึกษากายภาพของผิวหน้าและชิ้นงานสำหรับวัดทางแสงโดยเทคนิค PL	42
4.2	ความกว้างของเนินและความลึกจากยอดถึงพื้นในทิศ [110] และ [1-10] ของ	
	โครงสร้าง In _{0.15} Ga _{0.85} As/ <mark>GaAs และชิ้นง</mark> าน D	44
4.3	ค่าความสูง ความห <mark>นาแน่นข</mark> องควอน <mark>ตัมดอต แ</mark> ละขนาดของแนวเนิน ที่เกิดขึ้น	
	ในชิ้นงานที่ปลูก InAs ควอนตัมดอต <mark>แบบ SK บ</mark> นชิ้นงาน A, B และ C	
	ตามลำดับ โ <mark>ดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของชิ้นงานที่</mark> ปลูก InAs ควอนตัมดอต	
	แบบเดียวกันบนผิวหน้าของ GaAs โดยตรงของ S.Kiravittaya [79] และบน	
	In _{0.15} Ga _{0.85} /GaAs ของ C C Thet [80]	48



สารบัญภาพ

รูปที่		หน้า
2.1	โครงสร้างและ DOS ของ ก) ก้อนผลึก ข) บ่อควอนตัม ค) ลวดควอนตัม และ ง)	
	ควอนตัมดอต [38]	6
2.2	วิธีการปลูกคอนตัมดอตในหลายวิธี ก) การสร้างผลึกขนาดเล็ก	
	(microcrystallities) บนแก้ว ข) การใช้แบบพิมพ์เทียม ค) การเกิดควอนตัมดอต	
	แบบประกอบตนเอง [3 <mark>9,40, 41</mark>]	8
2.3	โหมดที่เป็นไปได้ข <mark>องการปลูก</mark> ผลึกในกา <mark>รปลูกแบบ</mark> เอพิแทกซี [41]	9
2.4	แสดงขั้นตอนกา <mark>รเกิดควอนตัมด</mark> อตแ <mark>บบ SK ในกา</mark> รปลูกแบบเอพิแทกซี โดย	
	ควอนตัมดอต <mark>มีการเกิดแบบสุ่</mark> ม (random) [13]	10
2.5	ตัวอย่างขั้นตอน <mark>การทำ pre-pattern substrate</mark> ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อทำ	
	แม่พิมพ์สำหรับเร <mark>ียงควอนตัมดอต โดยเริ่มต้นจากรูป</mark> ก) ปลูก AlGaAs ลงบน	
	GaAs (001) <mark>ซับสเตรต</mark> ข)ใ <mark>ช้ลิโทรกราฟีและการกั</mark> ดออกเพื่อให้ได้ผิวเรียบและ	
	โครงสร้างที่ต้องก <mark>าร ค</mark>) เคล <mark>ือบผิวด้วยส</mark> าร PMMA ซึ่งเป็นโฟโตรีสิสชนิดนึง ง)	
	ทำลวดลายบนผิวห <mark>น้</mark> ำด้ว <mark>ยลิโทกราฟีแบบล</mark> ำอิเล็กตรอน จ) กัดออกด้วยสารกัด(
	etchant) SiCl ₄ ฉ) โคร <mark>งสร้างที่สมบูรณ์พร้อ</mark> มลวดลายสำหรับปลูกควอนตัมดอต	
	ช) ภาพ AFM ลวดลายที่ได้จากการเตรียมในขั้นตอน ก-ฉ และ ซ) ภาพแสดงการ	
	เรียงตัวของควอนตัมดอตที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์ [48]	11
2.6	ภาพตัวอย่างลั <mark>กษณะของชิ้นงานที่เกิดจากการ miscut</mark> ทำให้เกิด surface step	
	ขึ้น [50]	12
2.7	ภาพ AFM ของควอนตัมดอตซึ่งปลูกบน GaAs (n11) ได้แก่ ก) GaAs (911) B,	
	า) GaAs (711) B, ค) GaAs (511) B, ง) GaAs (411) B และ จ) GaAs (311)	
	B [50]	12
2.8	ภาพ AFM ของชิ้นงาน ก) 17 ชั้นของ In _{0.5} Ga _{0.5} As ในการเกิดควอนตัมดอต	
	แบบโซ่ยาว รวมถึง ข) ภาพตัดขวาง TEM ของชิ้นงานในแต่ละด้าน [51]	14
2.9	แผนภาพแสดงการเกิดความเครียดแบบอัดเมื่อปลูกชั้น InGaAs บนชั้น GaAs	15
2.10	- กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาวิกฤติ (h _{.co})กับค่าสัดส่วน In(x)	
	ใน In _{1-x} Ga _x As ตามสมการที่ 2.6	17

รูปที่		หน้า
2.11	ระนาบการเคลื่อนที่ทั้งหมดของ 60 ° type dislocation บนระนาบ {111} พร้อม	
	แกนระบุทิศทาง โดย $ec{ m b}$ แสดงถึงเวกเตอร์หนึ่งของ dislocation ชนิดนี้ ซึ่ง $ec{b}=rac{1}{2}$	
	[0-11] อยู่ในระนาบ (111) [57]	18
2.12	ลักษณะเวกเตอร์การเคลื่อนที่ของ dislocation ที่ทำให้เกิด up step และ down	
	step โดยเมื่อโปรเจค เวกเตอร์ในทิศทาง [110] โดย $ec{b}=rac{1}{2}$ [10-1] ทำให้เกิดการ	
	เลื่อนในระนาบ (1-11) เกิด down-step และ $ec{b}=rac{1}{2}$ [0-11] ทำให้เกิดการเลื่อน	
	ในระนาบ (-111) เกิด up-step [57]	19
2.13	ขั้นตอนการเกิด <mark>surface s</mark> tep elimination โดยเรียงจาก ก) ขณะเริ่มเกิด	
	surface step ขึ้น จาก dislocation ข) ลักษณะของชั้นฟิล์มเมื่อเกิดการเลื่อน	
	ของผลึกจาก dislocation ค) ลักษณะการก่อตัวของชั้นฟิล์มจากการเลือกเกิด	
	บริเวณขอบข <mark>อง step ก่อนบริเวณอื่น จนเกิดการหล่นลงมาของชั้นผลึกเมื่อมี</mark>	
	ความหนามาก <mark>พอ ง) ผิวหนารูปแบบของลายตารางที่ส</mark> มบูรณ์โดยพื้นผิวมีความ	
	โค้งและเรียบ [5 <mark>6</mark>]	19
2.14	ก) ลักษณะของโ <mark>ครงส</mark> ร้าง GaAs/In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs ซึ่งมีลักษณะคล้ายบ่อ	
	ควอนตัมแคบๆ ข) <mark>แสดงลักษณะการถูกบ</mark> ีบบังคับจาก GaAs ทั้งสองด้านของ	
	ชั้น InGaAs เนื่องจากความไม่เข้ากันของโครงผลึก	20
2.15	ภาพ bright-field พร้อมกับลูกศรบ่งชี้ทิศทางตามระนาบของชิ้นงานที่ถูก	
	ตัดขวาง โดยภาพประกอบด้วย GaAs/In _{0.3} Ga _{0.7} As/GaAs ที่มีชั้นกลบทับ	
	GaAs ที่มีควา <mark>มห</mark> นา ก) 10 nm และ ข) 100 nm [58 <mark>]</mark>	20
2.16	ภาพ TEM แสดง ก) การแตกออกของ dislocation ในทิศทาง [-110] ข)	
	ลักษณะของเส้นซิกแซ็กที่เกิดขึ้นขณะกลบทับด้วยชั้น GaAs ที่มีความหนา 100	
	nm ค) ลักษณะการจัดเรียงของเส้นซิกแซ็ก [58]	21
2.17	ลักษณะของผิวหน้าเมื่อทำการปลูก InAs QDs บนชั้นความเครียด เมื่อมีจำนวน	
	ของชั้น SL ก) 10 nm ข) 15 nm และ ค) 30 nm [60]	22
3.1	ก) ภาพตัดขวางแสดงส่วนประกอบภายในห้องปลูกผลึก และ ข) หลักการ	
	ทำงานโดยคร่าวของเครื่อง MBE [59]	23
3.2	ก) ภาพถ่าย และ ข) โครงสร้างระบบปลูกผลึกของเครื่องปลูกลำโมเลกุล RIBER	
	รุ่น 32P	24
3.3	ก) ภาพเครื่องปั้มโมเลกุลเทอร์โบ และ ข) หลักการทำงานเบื้องต้น [62]	25

ป

รูปที่		หน้า
3.4	ลักษณะทั่วไปของซับสเตรตมานิพูเลเตอร์ [63]	26
3.5	ลักษณะทั่วไปของ Effusion cell [64]	26
3.6	ลักษณะทั่วไปของ hot filament ionization gauge ประกอบไปด้วยแท่งโลหะ 3	
	ชนิด ฟิลาเมนต์, กริด และคอลเลกเตอร์ [65]	28
3.7	โครงสร้างของระบบ RHEED [66]	28
3.8	ก) โครงสร้างและการทำงานโ <mark>ดยย่อของ</mark> Quadruple mass spectrometer และ	
	ข) วงจรการทำงานแ <mark>ท่งโลหะ 4 แท่งใน Qua</mark> druple mass spectrometer	
	[67,68]	29
3.9	ก) รูปถ่ายของร <mark>ะบบวัด PL ข) Schematic ขอ</mark> งระบบวัด PL [69]	30
3.10	ภาพถ่ายของเครื <mark>่อง SEIKO S</mark> PA <mark>400-AFM</mark>	30
3.11	ภาพแสดงการทำงานอ <mark>ย่างง่ายของ</mark> AFM [70]	31
3.12	โพรไฟล์อุณหภูมิ (Temperature profile) ของกระบวนการทำ pre-heat	32
3.13	โพรไฟล์อุณหภูมิของขั้นตอนก <mark>ารทำการ</mark> De-Ox พร้อมกระบวนการเปิดปิดชัต	
	เตอร์	33
3.14	ภาพ RHEED pa <mark>tterns ที่ได้จาก RHE</mark> ED Screen ของการเปลี่ยนแปลง	
	RHEED pattern จาก C(2x4) ไปเป็น C(4x4) ของพื้นผิว GaAs ในการหาค่า	
	อุณหภูมิ transition โดยเรียงลำดับจากรูป ก-ฉ	34
3.15	ตำแหน่งของ zero-order diffracted RHEED (00) beam บน RHEED Screen.	35
3.16	ลำดับขั้นต่างๆ <mark>ขอ</mark> งการเกิดเกาะสองมิติ (2D islands) ของการปลูกชั้นต่อชั้นของ	
	SrTiO $_{_3}$ และความเข้มของ zero-order diffracted RHEED beam ที่	
	เปลี่ยนแปลงไป [72]	35
3.17	ลักษณะการเปิดและปิดชัตเตอร์ของ In และ As ของการปลูก InAs ควอนตัม	
	ดอตแบบ SK แบบปกติและ SK แบบ MEE	38
3.18	แผนภาพเฟสสมดุล (Equilibrium phase diagram) ในรูปของฟังก์ชั้นระหว่าง H	
	กับ 8 โดยภาพประกอบด้านบนและล่างแสดงถึงลักษณะของผิวหน้าของโหมด	
	ต่างๆทั้ง 6 โหมด สามเหลี่ยมเล็กสีขาวแทนโครงสร้างเกาะสามมิติที่มี	
	เสถียรภาพ สามเหลี่ยมใหญ่ระบายสีข้างในแทนโครงสร้างเกาะสามมิติที่โต	
	เต็มที่ (Ripening island) เฟสแต่ละรูปแบบถูกแบ่งด้วยเส้นขอบเขต H _{c1} (E):	
	FM-R1, FM-SK1; $H_{c2}(\mathbf{\mathcal{E}})$: SK1-R2; $H_{c3}(\mathbf{\mathcal{E}})$: SK2-SK1; $H_{c4}(\mathbf{\mathcal{E}})$: VW-SK2,VW-	
	R3 [74]	39

4	
00	
7/1	

รูปที่		หน้า
3.19	ภาพจาก RHEED screen ขณะปลูกควอนตัมดอต InAs บนแผ่นฐานลายตาราง	
	In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs ก) เมื่อเริ่มเกิดควอนตัมดอต ข) เกิดควอนตัมดอตแล้ว ค)	
	Chevron pattern [34]	39
3.20	ความสัมพันธ์ของ Chevron pattern ต่อลักษณะทางกายภาพของควอนตัมดอต	
	[75]	40
3.21	ก) การกลบทับเพื่อท <mark>ำ Nanohole ข)</mark> การกลบทับแบบบางสำหรับปลูก	
	โครงสร้างควอนตัม <mark>ดอตความ</mark> หนา <mark>แ</mark> น่นสูง [76]	40
4.1	ภาพตัดขวางขอ <mark>งชิ้นงานในการทดลอง ก) โครงสร้</mark> างสำหรับศึกษาสมบัติทาง	
	กายภาพของผ <mark>ิวหน้าด้วยเทคนิค AFM ข) โครงสร้างสำหรับศึกษาสมบัติทางแสง</mark>	
	ด้วยเทคนิค PL	41
4.2	ภาพ AFM ขนาด 10x10 µm² <mark>แสดงลักษณะผิวหน้าที่ยั</mark> งไม่ได้ปลูกควอนตัมดอต	
	ก) โครงสร้าง <mark>50 nm In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs [33] และ ข) ชิ้นงาน D ซึ่งมี</mark>	
	โครงสร้าง 250 n <mark>m GaAs Spacer/ 50</mark> nm In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs และ ค) line	
	scan ของชิ้นงาน D ตามต <mark>ำแหน่งในรูป b)</mark>	43
4.3	ลำดับของการเปลี่ยนแป <mark>ลงผิวหน้าในการสร้างแม่</mark> พิมพ์สำหรับการก่อตัว	
	ควอนตัมดอตใหม่ โดยแสดงกลไกพร้อมลักษณะการก่อตัวของผิวหน้าของ	
	ชิ้นงาน ก) การเกิดลายตารางขึ้นจากการเลื่อนของระนาบผลึกเนื่องจาก misfit	
	และ threadin <mark>g</mark> dislocation ของชั้น In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs ข) การเพิ่มชั้น GaAs	
	spacer ทำให้แนวของ dislocation เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบางส่วนหยุดหรือ	
	เบี่ยงเบนไปจากทิศทางเดิม ในขณะที่มีบางส่วนผ่านขึ้นยังผิวหน้าได้ และ ค)	
	แสดงการเกิดของแนวเนินขนาดต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการเลื่อนของระนาบบน	
	ผิวหน้าและการเกิด surface step elimination	45
4.4	ภาพ AFM ของการปลูก 1.8 ML InAs QDs บน ก) In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs	
	ข) GaAs (100) ซับสเตรตพร้อมความสูง [77,79]	46
4.5	ภาพ AFM ขนาด 10x10 µm² แสดงลักษณะการก่อตัวของ InAs ควอนตัมดอต	
	ที่ปลูกด้วยวิธีแบบ SK ของ ก) ชิ้นงาน In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs ข) ชิ้นงาน A ค)	
	ชิ้นงาน B และ ง) ชิ้นงาน C ตามลำดับโดยในแต่ละรูปทางด้านมุมขวาบนมีรูป	
	ขยายขนาด 0.5x0.5 µm² ในบริเวณตำแหน่งที่สนใจและลูกศรสีขาวแสดง	
	ทิศทาง [1-10]	47

รูปที่		หน้า
4.6	ลักษณะการเปิดปิดชัตเตอร์ In และ As ในชิ้นงาน E และ F	49
4.7	ภาพ AFM ขนาด 10x10 µm ² ของชิ้นงาน F และ G ซึ่งปลูกควอนตัมดอตแบบ	
	MEE โดย over growth ก) 0% และ ข) 50% ตามลำดับ โดยในแต่ละรูป	
	ทางด้านมุมขวาบนมีรูปขยายขนาด 0.5x0.5 µm² ในบริเวณที่สนใจ และลูกศรสี	
	ขาวแสดงถึงทิศทาง [1-10]	49
4.8	สเปกตรัมการเปล่งแสงโดยทั่วไปของชิ้นงาน G โดยระบุตำแหน่งของยอด	
	พลังงานหลักที่เกิดขึ้น <mark>4 ค่า ด้วย สัญลักษณ์ I</mark> , II , III และ IV ตามลำดับ	51
4.9	กราฟแสดงผลของการเปล่งในการทดล <mark>องของ S.J.LEE</mark> [83]	52
4.10	กราฟแสดงการ <mark>กระจายตัว ก) ความสูงของควอ</mark> นตัมดอตและความกว้างใน	
	ทิศทาง ข) [1-10] และ ค) [110] ของชิ้นงาน C	53
4.11	สเปกตรัมการ <mark>เปล่งแสงของชิ้นงาน G เมื่อเปลี่ยนแปลงกำลังเลเซอร์ที่ใช้ในการ</mark>	
	กระตุ้นที่กำลัง <mark>แสงเลเซอร์กระตุ้นที่อุณหภูมิ 20 K</mark>	54
4.12	สเปกตรัมการเป <mark>ล่งแสงของชิ้นงาน G การเปล่งแสงเมื่อเปลี่ยนแปลงกำลัง</mark>	
	เลเซอร์ที่ใช้ในการ <mark>กระตุ้นที่กำลังเลเซอร์กระตุ้น 20</mark> mW พร้อมเส้นกราฟภายใน	
	แสดงยอดพลังงาน <mark>Gaussian ทั้ง 3 ค่ายอ</mark> ด	55
4.13	สเปกตรัมของแสงที่เปล่ง <mark>ออกจากชิ้นงาน G ที่</mark> อุณหภูมิต่างๆ (กราฟถูก offset	
	เพื่อความกระจ่าง)	56
4.14	ค่าความความเข้มแสงที่เปล่งออกจากค่ายอดพลังงานต่าง ๆ ของชิ้นงาน G เมื่อ	
	เปลี่ยนแปลงอ <mark>ุณ</mark> หภูมิ	57
4.15	ตำแหน่งของค่ายอดพลังงานของชิ้นงาน G ที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนแปลง	
	อุณหภูมิ	57
4.16	เปรียบเทียบค่ายอดพลังงานที่เปลี่ยนไปของยอดพลังงานที่ I และ II กับค่าที่ได้	
	จากสมการ Varshni พร้อมกับเส้นประที่ได้จากการปรับค่า E _o ในสมการ	
	Varshni	58
4.17	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มกับมุมโพลาไรส์ของยอดพลังงานทั้งสี่ที่	
	ปรากฏในรูปที่ 4.8	59

บทที่ 1

บทนำ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าสารกึ่งตัวนำมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งของสารกึ่งตัวนำก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ้อย่างมากโดยเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ใ<mark>นช่วง</mark>แรกๆของการพัฒนา สารกึ่งตัวนำชนิดแรกที่มีบทบาท ้สำคัญคือ ซิลิคอน (silicon) อุตสาห<mark>กรรมรวมถึงเทคโนโลยีใน</mark>ระยะแรก จึงมุ่งความสนใจไปยังคุณสมบัติ ้ต่างๆของซิลิคอน ทำให้เกิดสิ่งป<mark>ระดิษฐ์ต่าง</mark>ๆมา<mark>ก</mark>มาย <mark>ยกตัวอย่าง</mark>เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ซึ่งเป็น หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์พื้นฐานที่<mark>มีความสำคัญ เป็นต้น ซิลิคอนแทบจะต</mark>อบสนองความต้องการทุกอย่างที่มี ้ได้สำหรับนักประดิษฐ์ในข<mark>ณะนั้น อีกทั้งยังมีข้อดีที่สามารถ หาได้ง่ายแ</mark>ละมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ต่อมา เมื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ความต้องการความเร็วในด้านการ ้รับส่งข้อมูลจึงเพิ่มสูงตาม <mark>อุปกรณ์ไฟฟ้าเริ่มที่จะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์</mark>ทางแสง ทำให้ซิลิคอนไม่อาจที่จะ ้ใช้งานได้อีกต่อไป เนื่องจา<mark>ก</mark>มีค<mark>่าสภาพคล่<mark>องตัว (m</mark>obility) ที่ต่ำและเป็นสารจำพวกแบนด์แกปไม่ตรง</mark> (Indirect bandgap) ทำให้กา<mark>รเ</mark>ปล่งแ<mark>สงไม่ดีนัก จึงไม่เหมาะแ</mark>ก่การนำมาใช้ทำอุปกรณ์จำพวกแสง ์ ซิลิคอนจึงถูกแทนที่ด้วยสารกึ่งตัวนำช<mark>นิดใหม่ ซึ่งเป็นสารป</mark>ระกอบของธาตุหมู่ III-V อาทิเช่น GaAs ,InAs หรือ InP สารเหล่านี้เป็นสารแบนด์แกปตรง (Direct bandgap) จึงให้ประสิทธิภาพทางแสงที่ดีกว่า รวมถึงมีค่าความคล่องตัว (mobility) ที่มากขึ้นด้วย แต่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของความยาวคลื่น เนื่องจากในระบบสื่อสารจ<mark>ำเป็นต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นบางค่า</mark> [1] เช่น 850, 1300 และ 1550 nm เพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นให้ได้ตามที่ต้องการ จึงมีการปรับปรุงสารประกอบ III-V ไปเป็น สารประกอบจำพวกอัลลอยด์ เช่น In_xGa_{1-x}A_yP_{1-y} ซึ่งมี lattice match กับ InP [2] หรือ GaAlAs ที่มีค่า โครงผลึกตรงกัน (lattice match) กับ GaAs [3] ใช้ในการทำ เลเซอร์ (Laser) หรือ ไดโอดเปล่งแสง เป็นต้น สารเหล่านี้มีค่าความยาวคลื่นของแสงที่เปลี่ยนไปเมื่อสัดส่วนของสารประกอบ (LED) เปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยาวคลื่นได้โดยไม่ต้องค้นหาสารชนิดใหม่

เทคโนโลยีทางด้านการปลูกก็มีส่วนสำคัญ เบื้องหลังความสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่ เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านการปลูก เทคโนโลยีทางด้านปลูกในปัจจุบันพัฒนา ก้าวหน้าไปมาก ทำให้สามารถกำหนดค่าต่างๆ เช่น ปริมาณของสาร ที่น้อยมากๆได้อย่างแม่นยำ [4-5] รวมถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างได้ละเอียดในระดับอะตอม [6-8] ทำให้เพิ่มขีด ความสามารถไปอีกระดับหนึ่งคือสามารถออกแบบโครงสร้างของชิ้นงานในลักษณะต่างๆได้ คุณสมบัติ ของชิ้นงานจึงมีความหลากหลายมากขึ้น ถึงแม้จะใช้สารชนิดเดียวกันในการปลูกเพราะมีโครงสร้างที่ แตกต่างกัน การพัฒนาในปัจจุบันจึงเริ่มที่จะให้ความสนใจในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและขนาด ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการปลูก สิ่งประดิษฐ์ต่างๆในปัจจุบัน นอกจากที่ จะต้องใช้งานได้ดีแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีขนาดที่เล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น นาโนเทคโนโลยีจึง เข้ามามีบทบาทสำคัญ โครงสร้างของสารกึ่งตัวนำที่มีขนาดใหญ่ (bulk) ในอดีตถูกลดขนาดลงมาใน ระดับนาโนเมตร (nm) เกิดเป็นโครงสร้างชนิดใหม่ เช่น บ่อควอนตัม (Quantum well), ลวดควอนตัม (Quantum wire) และควอนตัมดอต (Quantum Dot)

้ควอนตัมดอตเป็นโค<mark>รงสร้างหนึ่งที่ไ</mark>ด้รับ<mark>ค</mark>วาม<mark>สนใจมาก เ</mark>นื่องจากมีคณสมบัติคล้ายๆกับอะตอม เทียม อาทิเช่น มีระดับพ<mark>ลังงานเป็นขั้นๆเหมือนอะตอมเนื่อง</mark>จากมีโครงสร้างที่เกิดการจำกัด (confinement) ใน 3 มิติ เป็นต้น ควอนตัมดอ<mark>ตจึงถูกนำไปประยุกต์ใช้</mark>ในหลายๆด้าน เช่น ใช้ในการทำ เลเซอร์ที่มีค่า threshold current ต่ำ [9-10] การ สร้างหรือปลูกควอนตัมดอตสามารถกระทำได้ในสอง รูปแบบคือแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) และแบบบนลงล่าง (Top-down) แบบบนลงล่าง คือการสร้าง ควอนตัมดอตโดยตรง เช่น หรื<mark>อการใช้กระบวนการลิโธกราฟี (lit</mark>hography) [11] หรือกระบวนการกัด ืออก (etching) [12] ข้อดีในแบ<mark>บบนลงล่าง คือสามา</mark>รถก<mark>ำห</mark>นดการเกิดควอนตัมดอตได้อย่างแน่นอน แต่มีปัญหาในเรื่องของ สถานะผิว (surface state) หรือ กับดัก (trap) บนชิ้นงาน ทำให้คุณภาพของ ชิ้นงานที่ได้ไม่ดีนัก อีกวิธีหนึ่งคือแบบล่างขึ้นบนคือ การเกิดควอนตัมดอตแบบเกิดขึ้นเองโดยอาศัย ความเครียดที่เกิดจากความไม่เข้ากันของโครงผลึก ซึ่งเกิดได้ในสารกึ่งตัวนำหลายระบบ เช่น InAs/GaAs [13-15], Ge/Si [16], CdSe/ZnSe [17,18], CdS/Zn(S)Se [19], PbSe/PbEuTe [20] ,(InGa)As/(AIGa)As [21], ,AIInAs/AIGaAs [27], GaN/AIN [24,25], InGaN/GaN [26], InP/InGaP [27] และ GaSb/GaAs [28] มีจุดเด่นในเรื่องของ defect ที่มีน้อยมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของการ จัดเรียงตัวของควอนตัมดอตเนื่องจากควอนตัมเกิดขึ้นเองในลักษณะสุ่มทั่วบริเวณผิวหน้า ซึ่งถ้า ปราศจากปัญหาดังกล่าวจะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีควอนตัมดอตที่มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลาย มากขึ้นในการใช้งาน

ปัญหาในเรื่องการจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตแบบเกิดขึ้นเองจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีหลายๆกลุ่มวิจัยได้พยายามศึกษาและใช้วิธีต่างๆเพื่อที่จะจัดเรียงควอนตัมดอตแบบเกิดขึ้นเองให้มี ระเบียบ มีรูปแบบที่แน่นอน เช่น ควอนตัมดอตแบบโซ่ [29] ,ควอนตัมดอตแบบแหวน [30] ,ควอนตัม ดอตแบบลายตาราง [31,32] ฯลฯ

้สำหรับในกลุ่มวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (SDRL) ได้ทำการศึกษาการ จัดเรียงตัวของควอนตัมดอตเช่นกันโดยอาศัยชั้นลายตารางซึ่งเกิดจากการปลูกชั้นของ In Ga, As ลงบน แผ่นฐาน GaAs ชั้นลายตารางดังกล่าวทำให้เกิดการจัดเรียงของควอนตัมดอตแบบเส้นในทิศ [110] และ ทิศ [1-10] โดยในกลุ่มวิจัย SDRL ได้พยายามศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดชั้นลายตารางที่ ดีที่สุดในการจัดเรียงควอนตัมดอต เริ่มต้นจากการศึกษาถึงผลของความหนาและค่าสัดส่วนของ In ในชั้น ลายตารางที่มีต่อรูปแบบการเกิดลวดลายตารางด้านบน โดยจากการทดลองโดย C.C. Thet [33] พบว่า ้ยิ่งค่าความหนาและค่าสัดส่วน In เพิ่มมากขึ้น ยิ่งทำให้เกิดการผ่อนคลายของพลังงานความเครียดใน ระบบ ในระบบที่มีการผ่อนคลายคว<mark>ามเครียดน้อย ลวดล</mark>ายตารางที่เกิดขึ้นจะเกิดเป็นเนินขนาดเล็กที่ เรียงตัวเป็นเส้นยาวในทิศ [110<mark>] และทิศ [1</mark>-10] เน<mark>ินแต่ละเนินมี</mark>ระยะห่างกันอย่างชัดเจนและมีจำนวน ของเส้นเนินน้อย ในระบบที่มี<mark>การผ่อนคลาย</mark>ความเคร<mark>ียดสูง เนินที่</mark>เกิดขึ้นจะมีความสูงและจำนวนที่มาก ู้ขึ้น พร้อมกันนี้ยังสังเกตเห็น<mark>การซ้อนทับกัน ทำให้เกิดแนวของเนินขนา</mark>ดใหญ่ขึ้นทั้งสองทิศทาง ต่อมาเมื่อ ทำการปลุกควอนตัมดอตล<mark>งไปยังแนวของเนินลายตารางที่เกิดขึ้นจะเกิ</mark>ดการก่อตัวของควอนตัมแบบเส้น บนแนวของแนวเนินดังกล่<mark>าว แต่จากการศึกษาเพิ่มเติมโดย T. Limwon</mark>gse [34] พบว่า ในความเป็นจริง ้ควอนตัมดอตจะเริ่มก่อตัวบ<mark>นบริเวณ threading dislocation ก่อน</mark>บริเวณอื่น จากนั้นจึงเกิดขึ้นบริเวณ ็จุดตัดกันของแนวเนิน ตามด้ว<mark>ยเกิด</mark>บนแน<mark>วเนินในทิศ [1-10] และ</mark>ทิศ [110] ตามลำดับก่อนที่จะเกิดใน ้บริเวณพื้นเรียบนอกแนวเนิน เมื่อ<mark>ทราบถึงพฤติกรรมก</mark>ารก่อตัวของควอนตัมดอตและผลของการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของลวดลาย<mark>ตารางจึงทำให้สามารถก</mark>ำหนดแม่แบบในการจัดเรียงตัวควอนตัมที่ เหมาะสมได้ตามที่ต้องการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการปรับปรุงชั้นของแผ่นฐานเสมือนลายตารางด้วยชั้น GaAs spacer โดยอาศัยแผ่นฐานเสมือนลายตารางประกอบด้วยชั้นของ In_{0.15}Ga_{0.85}As บนแผ่นฐานGaAs ระนาบ (100) ((100) – GaAs) โดยอาศัยเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนการปลูกของชั้นลายตารางตามที่ได้ กล่าวถึงของ Cho Cho Thet และนายธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ แผ่นฐานลายตารางจะต่างจากแผ่นฐานทั่วไปคือ ภายในแผ่นฐานลายตารางจะมีความผิดปกติทางตำแหน่งของอะตอม ส่งผลต่อเนื่องไปยังผิวหน้าด้วย มุม 60° จากแนวระนาบ ความผิดปกติของโครงผลึกมีสองรูปแบบ คือ threading dislocations และ misfit dislocation [35,36] ก่อให้เกิดเนิน (ridge) เรียงเป็นแนวยาวในทิศ [110] และทิศ [1-10] บน ผิวหน้าของชิ้นงาน ลักษณะที่เกิดขึ้นเกิดจากการผ่อนคลาย (relax) ความเครียดบางส่วนที่สะสมจาก ความไม่เข้ากันของโครงผลึก InGaAs กับ GaAs การปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวโดยการเพิ่มชั้นของ GaAs ที่มีความหนาลงไป จะทำให้เกิดโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายๆบ่อควอนตัมขึ้น ส่งผลให้แนวของ dislocation ที่มีอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และในขั้นสุดท้ายจึงทำการปลูกควอนตัมลงไปบนชั้น GaAs ที่หนานี้เพื่อศึกษาการจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตและผลทางแสง

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาปรับปรุงแผ่นฐานเสมือนลายตารางนี้ คือความเป็นไปได้ที่จะ ควบคุมและเปลี่ยนแปลงทิศการเกิดขึ้นของควอนตัมดอตในรูปแบบใหม่ เช่นการเรียงตัวของควอนตัม ดอตแบบเส้นในทิศเดียว เนื่องจากแนวของ dislocation ที่เปลี่ยนแปลงด้วยผลของชั้น GaAs ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงคุณภาพทางแสงของชิ้นงานในโครงสร้างของแผ่นฐานลาย ตารางเสมือนเดิมเนื่องจากการลดลงของผลจาก dislocation

เนื้อหาในบทต่อไปของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทที่ 2 ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับควอนตัมดอต ชั้นลายตาราง และชั้น GaAs spacer บทที่ 3 การปลูกโครงสร้างและการวัด ลักษณะสมบัติ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในการปลูกโครงสร้างด้วยเทคนิคอีพิแทกซีลำโมเลกุล หรือ MBE รวมทั้งระบบวัดลักษณะสมบัติและระบบตรวจวัดขณะปลูกโครงสร้างทั้งแบบติดตั้งภายในและภายนอก เครื่องปลูกผลึก บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงวิวัฒนาการการเกิดควอนตัมดอต บนลายตารางและความสำคัญของข้อมูลดังกล่าว และบทที่ 5 สรุปผลการทดลอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐาน

บทที่ 2

2.1 ควอนตัมดอต

ขนาดมีผลต่อสมบัติของสารกึ่งตัวนำ โดยทั่วไปสมบัติต่างๆของสารกึ่งตัวนำเช่น สมบัติการนำ ไฟฟ้า สมบัติการนำความร้อน สามารถอธิบายได้โดยใช้อิเล็กตรอนเป็นหลัก อิเล็กตรอนในที่นี้จะ ้พิจารณาเป็นอนภาคขนาดเล็กที่มีประจ<mark>ุลบ แต่เมื่อส</mark>สารมีขนาดเล็กลงมาก อิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนภาค ้พื้นฐานของทุกอะตอมจะประพฤ<mark>ติตัวคล้ายคลื่นตามกลศาสต</mark>ร์ควอนตัม ทำให้สมบัติของสารกึ่งตัวนำ เปลี่ยนแปลงไปเดิม สสารทุก<mark>ชนิดสามารถ</mark>ประพฤติ<mark>ตัวเป็นคลื่นได้</mark>เมื่อมีขนาดที่เหมาะสมตามหลักทวิ ภาพของอนุภาค-คลื่น (wave-particle duality) ของหลุยส์ เดอ บรอยล์ (Louis de Broglie) โดยยิ่งมี ้ขนาดใหญ่เท่าใดโอกาสที่จะแสดงคุณสมบัติแบบคลื่นก็มีน้อยลง เนื่องจากความยาวคลื่นของเดอ ้บรอยล์มีขนาดที่เล็กมาก แต่<mark>สำหรับอนภาคขนาดเล็กมาก เช่น อิเล็</mark>กตรอน ค่าความยาวคลื่นของเดอบ รอยล์จะอยู่ในระดับนาโนเมต<mark>ร</mark> อิเ<mark>ล็กตรอนจึงแสดงพฤติกรรมคล้าย</mark>คลื่นได้โดยเฉพาะในโครงสร้างนาโน เช่น บ่อควอนตัม เส้นควอนตั<mark>ม และควอนตัมดอต เป็นต้น อิเ</mark>ล็กตรอนในโครงสร้างขนาดเล็กจะเกิด ้ควอนตัมคอนไฟน์เมนต์ (Quant<mark>u</mark>m confinement) คือ คว<mark>าม</mark>มีอิสระในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะ ถูกจำกัด อิเล็กตรอนจะถูกบังคับให้อ<mark>ยู่สถานะพลังงาน</mark>บางสถานะ (state) เท่านั้น ผลที่ตามมาคือ ระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนจะไม่ต่อเนื่อง (discrete energy level) สามารถอธิบายได้ตามหลัก กลศาสตร์ควอนตัม เช่น ในกรณีของอนภาคในกล่อง ลักษณะของควมหนาแน่นของสถานะ (Density of State) หรือ DOS ของโครงสร้างต่างๆในฟังก์ชันของพลังงานแสดงดังรูป 2.1 ความแตกต่างของ DOS ใน แต่ละโครงสร้างขึ้นอยู่กับระดับการถูกจำกัดของอิเล็กตรอน ในโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ (bulk) อิเล็กตรอนมีอิสระในการเคลื่อนที่มาก DOS ปรากฏในลักษณะที่ต่อเนื่อง ในขณะที่ DOS ของโครงสร้าง นาโนจะปรากฦในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากอิเล็กตรอนถูกจำกัดอิสระในการเคลื่อนที่ในแต่ละมิติ ้โดยถูกจำกัด 1 มิติในบ่อควอนตัมหรือฟิล์มควอนตัม ถูกจำกัด 2 มิติในลวดควอนตัม และถูกจำกัดทั้ง 3 มิติในควอนตัมดอต ซึ่งเป็นการถูกจำกัดโดยสมบูรณ์คล้ายกับอิเล็กตรอนในอะตอม ควอนตัมดอตใน บางครั้งจึงถูกเรียกว่าอะตอมเทียม และเป็นในโครงสร้างที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน

ควอนตัมตอตเป็นโครงสร้างขนาดนาโนเมตรทุกมิติประกอบขึ้นจากอะตอมของสาร มีคุณสมบัติ เฉพาะตัวทั้งด้านการเปล่งแสงและการนำไฟฟ้า ตามลักษณะของ DOS และระดับพลังงานของ อิเล็กตรอนในโครงสร้าง DOS ของควอนตัมดอตในกรณีอย่างง่ายที่สุดโดยคิดควอนตัมดอตเป็นกล่อง ทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ทำให้สามารถเขียนสมการ Schrödinger และใช้เงื่อนไขขอบเขตของรูปทรง ร่วมกับการแก้สมการอนุพันธ์กำลังสอง ถูกแสดงได้ในสมการ 2.1 [37]

$$D_{QD}(E) = 2\sum_{l,m,n} \delta\left\{ E - \frac{\overline{h^2}\pi^2}{2m^*} \left[\left(\frac{n_x}{L_x} \right) + \left(\frac{n_y}{L_y} \right) + \left(\frac{n_z}{L_z} \right) \right] \right\}$$
 2.1

โดย m* คือมวลประสิทธิผลของอิเล็กตรอนใน conduction band, L_x, L_y และ L_z คือขนาดของ ควอนตัม ดอตในแนวแกน x, y และ z ตามลำดับ, n_x, n_y และ n_z คือเลขควอนตัมหลัก (Principal quantum number) และ E คือ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนดังสมการที่ 2.2

$$E = \frac{\overline{h^2 \pi^2}}{2m^*} \left[\left(\frac{n_x}{L_x} \right) + \left(\frac{n_y}{L_y} \right) + \left(\frac{n_z}{L_z} \right) \right]$$
 2.2

ค่า D(E) ของควอนตัมดอตในรูปที่ 2.1 d) จะแตกต่างจากโครงสร้างอื่นในรูป 2.1 ก) – ค) คือ มีลักษณะ เป็นดิแรกเดลตาฟังก์ชัน (Dirac delta function) คือไม่มีโค้งการกระจาย (dispersion curve) ที่บ่งบอก การมีอยู่ของสถานะในระดับพลังงานอื่นใกล้เคียง ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่มีอิสระในการ เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทั้งสามมิติ นอกจากนี้ยังมีควอนตัมดอตในรูปทรงอื่นๆเช่นรูปทรงกลม รูปพีรามิต



รูปที่ 2.1 โครงสร้างและ DOS ของ ก) ก้อนผลึก ข) บ่อควอนตัม ค) ลวดควอนตัม และ ง) ควอนตัมดอต [38]

(pyramid) หรือรูปทรงเลนส์ (lens) การคำนวณจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีเงื่อนไขขอบเขตที่ แตกต่างกันออกไป

ระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงการมีอยู่อย่างชัดเจนของอิเล็กตรอนในบางระดับพลังงานของ ควอนตัมดอต การกระตุ้นโดยศักย์ไฟฟ้าหรือแสงเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าหรือการเปล่งแสง ขึ้น โดยแสงที่ได้เป็นแสงที่มีความเข้มสูง ควอนตัมดอตจึงมีค่าความไวไฟฟ้าและการเปล่งแสงที่ดี คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการของควอนตัมดอตคือการปรับเปลี่ยนค่าช่องว่างแถบพลังงาน (band gap) โดยทั่วไปการนำไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนจากวาเลนซ์แบนด์กระโดดขึ้นไปยังชั้นว่างเปล่าที่เรียกว่า แถบตัวนำ (conduction band) ซึ่งทำให้เกิดโฮล (hole) ในแถบเวเลนซ์ (valence band) และอิเล็กตรอน เพิ่มขึ้นในชั้นแถบการนำ ระยะห่างระหว่างคู่อิเล็กตรอนและหลุมที่เกิดขึ้นเรียกว่า "รัศมีเอกซิตอนบอร์" (exciton bohr radius) ค่านี้เป็นตัวกำหนดสมบัติการนำไฟฟ้ารวมถึงสมบัติการเปล่งแสง ซึ่งค่านี้เองก็ ขึ้นอยู่กับขนาดและสัดส่วนของสารในควอนตัมดอต

จากคุณสมบัติที่กล่าวมาควอนตัมดอตจึงสามารถนำไปใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่าง หลากหลาย เช่น ตัวตรวจจับกระแสที่มีความไวสูง ทำแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ หรือใช้ในการพัฒนา ประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะ เป็นต้น ซึ่งมีใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน

2.2 การปลูกควอนตัมดอต

การสร้างหรือปลูกควอนตัมดอตทำได้ในหลายวิธี เช่น การสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาทางเคมี เช่น การเกิดผลึกขนาดเล็กของ CdSe บนแก้วดังรูปที่ 2.2 ก), การสร้างควอนตัมดอต จากแม่พิมพ์เทียมโดย กระบวนการลิโธกราฟีของโครงสร้างฟิล์มบางแล้วทำการกัดออก เช่น ควอนตัมดอตแนวตั้งจาก AlGaAs/InGaAs/AlGaAs double barrier heterostructure (รูปที่ 2.2 ข)) และการเกิดขึ้นเองของ ควอนตัมดอตในกระบวนการเกิดแบบประกอบด้วยตัวเอง (self-assembled) ในรูปที่ 2.3 ค) โดยแต่ละ วิธีที่กล่าวมามีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน สำหรับการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้วิธีการเกิดขึ้น เองของควอนตัมดอตแบบประกอบตนเองแบบ Stranski-Krastanow (SK) เป็นหลัก



รูปที่ 2.2 วิธีการปลูกคอนตัมดอตในหลายวิธี ก) การสร้างผลึกขนาดเล็ก (microcrystallities) บนแก้ว ข) การใช้แบบพิมพ์เทียม ค) การเกิดควอนตัมดอตแบบประกอบตนเอง [39, 40, 41]

2.2.1 การปลูกควอนตัมดอต โดยวิธี Stranski-Krastanow

การปลูกขั้นของสารชนิดหนึ่งลงบนสารอีกชนิดหนึ่งโดยวิธีเอพิแทกซี (epitaxy) หรือ เฮเทอโร เอพิแทกซี (heteroepitaxy) ความแตกต่างของค่าคงที่โครงผลึก (lattice constant) เป็นปัจจัยสำคัญที่ ต้องคำนึงดังแสดงในรูปที่ 2.3 การปลูกขั้นของสารที่มีค่าคงที่โครงผลึกต่างกัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 %) การปลูกขั้นของสารจะเป็นแบบ 2 มิติโดยตลอด กล่าวคือ ผลึกจะก่อตัวแบบขั้นต่อขั้น (layer to layer) หรือการปลูกแบบ Frank-van der Merwe (FM) บนชั้นของสารอีกชนิดหนึ่ง สำหรับสารที่มีค่าคงที่โครง ผลึกต่างกัน (มากกว่า 10%) ชั้นของสารที่เกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะ 3 มิติ หรือเกาะ (island) ตั้งแต่ เริ่มแรกของการปลูก การปลูกชนิดนี้เรียกว่าการปลูกแบบ Volmer-Weber (VM) ในกรณีที่สามารถ กำหนดความแตกต่างให้พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป (5% <٤< 10%) การปลูกจะปรากฏในรูปแบบผสม คือ เริ่มแรกจะเป็นแบบ 2 มิติและพัฒนาต่อไปเป็นแบบ 3 มิติ เรียกว่า การปลูกแบบ Stranski-Krastanow (SK)

กลไกของการเกิดควอนตัมดอตในแบบ SK ดังแสดงในรูป 2.4 เริ่มต้นจากการปลูกสารชนิดหนึ่ง ลงบนสารอีกชนิดหนึ่ง ในที่นี้คือการปลูก InAs บน GaAs เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ให้ความสนใจในการ เกิดควอนตัมดอต ค่าคงที่ผลึกของ InAs และ GaAs จะแตกต่างกันประมาณ 7 % ในขั้นแรกๆของการ ปลูกจะเป็นการปลูกแบบ 2 มิติ สารที่ทำการปลูกคือ InAs จะถูกบังคับให้การก่อตัวเป็นไปในแนว เดียวกับ GaAs ผลที่ได้คือเกิดความเครียดขึ้นในขั้นสาร InAs ซึ่งในที่นี้คือความเครียดแบบอัด (compressive strain) เมื่อความหนาของขั้นสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นและสะสมใน รูปแบบของพลังงานความเครียดยืดหยุ่น (elastic strain energy) จนถึงความหนาค่าหนึ่งซึ่งเรียกว่า ค่า ความหนาวิกฤติ (critical thickness) ค่าความเครียดจะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวและเกิดการผ่อนคลายขึ้นเมื่อ ความหนาเพิ่มขึ้นอีกในลักษณะของการก่อตัวของเกาะเล็ก ๆ ซึ่งคือ ควอนตัมดอตแบบประกอบตนเอง (Self-Assembled Quantum Dot)

ควอนตัมดอตแบบประกอบตนเองสามารถสร้างได้โดยการอาศัยเครื่อง MBE หรือเครื่อง Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) พร้อมกันนี้ยังสามารถเลือกใช้ระบบของสารที่จะเกิด ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น III-V,II-VI และ IV-IV ในส่วนของคุณสมบัติของดอตทางด้านขนาด, รูปร่าง , ส่วนประกอบและความหนาแน่นสามารถกำหนดได้อย่างยืดหยุ่นโดยอาศัยเงื่อนไขการปลูก เช่น อุณหภูมิชับสเตรต,อัตราส่วนฟลักซ์ของสารหมู่ III และสารหมู่ V, ความหนาชั้นสารที่ปกคลุม (monolayer coverage) [42] รวมถึงอัตราการปลูกในการปลูก InAs ควอนตัมดอต และ InGaAs ควอนตัมดอต [43] ล้วนมีผลต่อขนาดและความหนาแน่นของควอนตัมดอตทั้งสิ้น โดยสามารถอธิบาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้โดยอาศัยปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนของผิวหน้าและกระบวนการแพร่ซึม (diffusion) นอกจากนี้การกลบทับ(capping) [44] รวมถึงการปลูกเกินปกติ (overgrowth) [45] ก็ส่งผล ต่อคุณสมบัติของควอนตัมดอตเช่นกัน



ฐปที่ 2.3 โหมดที่เป็นไปได้ของการปลูกผลึกในการปลูกแบบเอพิแทกซี [41]



Random Formation

รูปที่ 2.4 แสดงขั้นตอนการเกิดควอนตัมดอตแบบ SK ในการปลูกแบบเอพิแทกซี โดย ควอนตัมดอตมีการเกิดแบบสุ่ม (random) [13]

2.3 การกำหนดตำแหน่งของควอนตัมดอต

ข้อจำกัดที่สำคัญของควอนตัมดอตแบบประกอบตัวเองคือ การเกิดขึ้นมาอย่างไม่เป็นระเบียบ การประยุกต์ใช้ในงานบางอย่าง เช่น Single electron transistor [46], Quantum cellular automata [47] จำเป็นต้องใช้ควอนตัมดอตที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ความต้องการใช้ควอนตัมดอตให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดจึงนำไปสู่ความพยายามในการควบคุมตำแหน่งควอนตัมดอต

้วิธีการจัดเรียงควบคุมตำแหน่งการเกิดของควอนตัมดอตแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

- 1. การใช้แม่พิมพ์บังคับให้เรียง (Force alignment template)
- การเรียงด้วยตนเองด้วยแม่พิมพ์วิศวกรรมความเครียด (Self-alignment strainengineering pattern)

2.3.1 การใช้แม่พิมพ์บังคับให้เรียง (Force alignment template)

การใช้แม่พิมพ์ที่เกิดจากการบังคับให้เกิด คือการทำลวดลายให้ได้ตามที่ต้องการบนซับสเตรต ก่อนจะทำการปลูกควอนตัมดอต วิธีดังกล่าวได้แก่

2.3.1.1 ซับสเตรตที่มีลวดลายเบื้องต้น (Pre-patterned substrate)

การทำซับสเตรตที่มีลวดลายก่อนเป็นกระบวนการทำลวดลาย (pattern) บนซับสเตรตก่อนที่จะ ทำการปลูกควอนตัมดอตเพื่อใช้ลวดลายดังกล่าวในการกำหนดตำแหน่งการเกิดของควอนตัมดอต ขั้นตอนทั่วไปสามารถอธิบายได้ดังนี้ เริ่มต้นจากการเคลือบน้ำยาโฟโตรีสิส (photoresist) ไว้ด้านบนของ ชิ้นงาน จากนั้นจึงอาศัยการทำลิโธกราฟีด้วยลำแสงต่างๆเช่น ลำอิเล็กตรอน (electron beam) [48] หรือ ลำไอออน (ion-beam) [49] ถ่ายทอดและสร้างลวดลายขึ้นบนชิ้นงาน เมื่อผ่านกระบวนการลิโทกราฟี (lithography) คุณสมบัติของโฟโตรีสิสในตำแหน่งที่ถูกแสงและไม่ถูกแสงจะมีคุณสมบัติต่างกัน เช่นในโฟ โตรีสิสชนิดลบ (negative) ตำแหน่งที่ถูกแสงจะมีการแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ถูกแสง ซึ่งตรง ข้ามกับโฟโตรีสิสชนิดบวก (positive) จากนั้นจึงกัดออกด้วยน้ำยาเคมีบางชนิดซึ่งจะกัดโฟโตรีสิสออกใน บางตำแหน่งคือตำแหน่งของสารที่ไม่แข็งตัวเท่านั้น ทำให้ได้ลวดลายที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบบนชั้น แผ่นฐาน ดังแสดงในรูป 2.5 ขั้นตอนสุดท้ายจึงทำการปลูกควอนตัมดอตลงไปบนชิ้นงานอีกทีหนึ่ง ควอนตัมดอตจะเริ่มก่อตัวอย่างไม่เท่ากันบนชิ้นงาน โดยจะก่อตัวในบริเวณที่ทำลวดลายไว้ก่อนบริเวณ อื่น ทำให้ได้ควอนตัมดอตเรียงตัวตามที่ต้องการ วิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องความละเอียด ความแม่นยำ ในกระบวนการลิโธกราฟีรวมถึงความสามารถในการถ่ายโอนแม่พิมพ์ เนื่องจากกระบวนการมีความ ซับซ้อนจึงอาจก่อให้เกิด defect ขึ้นระหว่างขั้นตอนการทำ



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างขั้นตอนการทำ pre-pattern substrate ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อทำแม่พิมพ์สำหรับเรียง ควอนตัมดอต โดยเริ่มต้นจากรูป ก) ปลูก AlGaAs ลงบน GaAs (001) ซับสเตรต ข)ใช้ลิโทรกราฟีและ การกัดออกเพื่อให้ได้ผิวเรียบและโครงสร้างที่ต้องการ ค) เคลือบผิวด้วยสาร PMMA ซึ่งเป็นโฟโตรีสิส ชนิดนึง ง) ทำลวดลายบนผิวหน้าด้วยลิโทกราฟีแบบลำอิเล็กตรอน จ) กัดออกด้วยสารกัด(etchant) SiCl₄ ฉ) โครงสร้างที่สมบูรณ์พร้อมลวดลายสำหรับปลูกควอนตัมดอต ช) ภาพ AFM ลวดลายที่ได้จาก การเตรียมในขั้นตอน ก-ฉ และ ซ) ภาพแสดงการเรียงตัวของควอนตัมดอตที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์ [48]

2.3.1.2 ซับสเตรตดัชนีสูง (High index substrate)

สำหรับอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการจัดเรียงควอนตัมดอตคือการใช้ซับเสตรตดัชนีสูง (High index substrate) (n11) เช่น ซับสเตรต GaAs (311) B, GaAs (411) B, GaAs (511) B เป็นต้น ซับสเตรต

เหล่านี้เป็นซับสเตรต ชนิดพิเศษซึ่งมีทิศทางการตัดแผ่นผลึก (wafer) ที่แตกต่างจากแบบทั่วไป ดังแสดง ในรูปที่ 2.6 ซึ่งจากรายงานของ Wang และคณะ [50] พบว่าควอนตัมดอตที่เกิดจากการปลูกบนแผ่น ซับสเตรตเหล่านี้มีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยแตกต่างกันตามทิศทางการตัดซับสเตรต ดัง แสดงรูปที่ 2.7 ถึงแม้วิธีนี้จะให้ควอนตัมดอตที่มีคุณภาพดีรวมถึงผลการเรียงตัวเป็นที่น่าพอใจ แต่เป็นวิธี ที่ไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากปัญหาในเรื่องราคาของชิ้นแผ่นฐานพิเศษที่ค่อนข้างสูง



รูปที่ 2.6 ภาพตัวอย่างลักษณะของชิ้นงานที่เกิดจากการ miscut ทำให้เกิด surface step ขึ้น [50]



รูปที่ 2.7 ภาพ AFM ของควอนตัมดอตซึ่งปลูกบน GaAs (n11) ได้แก่ ก) GaAs (911) B, ข) GaAs (711) B, ค) GaAs (511) B, ง) GaAs (411) B และ จ) GaAs (311) B [50]

2.3.2 การจัดเรียงตนเองด้วยลวดลายวิศวกรรมความเครียด (Self-alignment strain engineering pattern)

การเรียงตัวของควอนตัมดอตที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นเป็นวิธีที่อาศัยขั้นตอนเพิ่มเติมจาก ภายนอก การเรียงตัวของควอนตัมดอตสามารถทำได้ภายในขั้นตอนการปลูกเช่นกัน วิธีการปลูกชนิดนี้ จะอาศัยความเครียดเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียง เนื่องจากความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด ควอนตัมดอต การกำหนดและออกแบบความเครียดที่เหมาะสมจึงเป็นไปได้ที่จะจัดเรียงควอนตัมดอตให้ เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าวิศวกรรมความเครียด(strain engineering) ซึ่งคือการออกแบบและจัดการกำหนดความเครียดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ควอนตัมดอตเกิดขึ้นในบริเวณ ต้องการ

วิศวกรรมความเครียดสามารถทำได้โดยอาศัยความเครียดที่เกิดขึ้นบนผิวหน้า เช่นเดียวกับการ เกิดควอนตัมดอต โดยอาศัยความไม่เข้ากันของโครงผลึกในระบบ III- V หรือ II- VI รวมถึงการกลบทับ โครงสร้างบางอย่าง เช่น ควอนตัมดอต หรือ โฮล ทำให้เกิดความเครียดสะสมอยู่เฉพาะในบางบริเวณ เท่านั้นโดยกระบวนการทั้งหมดกระทำรวมอยู่ในขั้นตอนการปลูก จากหลักการที่ว่าควอนตัมดอตเลือกก่อ ตัวในบริเวณที่มีความเครียดสะสมอยู่ก่อนบริเวณอื่น จึงสามารถนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการ กำหนดการก่อตัวของควอนตัมดอตได้ การเรียงตัวเองของควอนตัมดอตที่เกิดจากแม่พิมพ์วิศวกรรม ความเครียด ได้แก่ ควอนตัมดอตแบบสายโซ่ยาวโดยการใช้ความเครียดที่เกิดจากสุปเปอร์แลตทิส (superlattice), ควอนตัมดอตแบบลายตาราง (cross-hatch) ซึ่งเกิดจาก misfit dislocation ใน โครงสร้าง InGaAs/GaAs หรือ InGaP/GaP เป็นต้น โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้โครงสร้าง InGaAs/GaAs เป็นแม่พิมพ์วิศวกรรมความเครียด (strain engineered template) ชนิดหนึ่งเป็นหลักใน การศึกษา

2.3.2.1 แม่พิมพ์ซุปเปอร์แลตทิช (Superlattice templates)

การเรียงตัวควอนตัมดอตแบบแนวเดียวเป็นโซ่ยาวถูกทำขึ้นโดยกลุ่มของ Wang [51] เป็นการ เรียงตัวโดยใช้วิศวกรรมความเครียดรูปแบบหนึ่ง กระทำโดยการปลูกควอนตัมดอต In(Ga)As แล้วกลบ ด้วยชั้น GaAs บางๆ ทำเซ่นนี้สลับกันหลายๆครั้งเป็นวัฐจักร ซึ่งเรียกว่า ซุปเปอร์แลตทิส ควอนตัมดอต ในชั้นล่างๆจะเหนี่ยวนำให้เกิดตำแหน่งของควอนตัมดอตในชั้นถัดไปจนถึงจำนวนวัฏจักรการปลูกที่ เหมาะสม การก่อตัวควอนตัมดอตในการปลูกครั้งต่อไปจะเริ่มเรียงตัวเป็นแนวโซ่ยาวในทิศทางเดียวอย่าง ชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 2.8 การเรียงตัวแบบโซ่ยาวมีปัจจัยที่ต้องควบคุมหลายประการ เช่น ปริมาณ InGaAs ในการปลูกควอนตัมดอต, ผลของ growth interrupt time และความหนาของชั้น GaAs ที่คั่น การปลูกด้วยวิธีนี้จึงมีความซับซ้อนและกระทำได้ยากเพื่อให้เกิดควอนตัมดอตแบบสายโซ่ยาวที่เรียง ตัวอย่างสวยงาม



รูปที่ 2.8 ภาพ AFM ของชิ้นงาน ก) 17 ชั้นของ In_{0.5}Ga_{0.5} As ในการเกิดควอนตัมดอตแบบโซ่ ยาว รวมถึ<mark>ง ข) ภาพตัดขวาง TEM ของชิ้นงานในแต่ละด้าน [51]</mark>

2.3.2.2 ลวดลายตาราง (Cross-hatch patterns): InGaAs/GaAs

ลวดลายตารางที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นเองในระบบการปลูกแบบเฮเทอโร เอพิแทกซี ซึ่งพบได้ในหลายระบบ เช่น InGaAs/GaAs [31,52], GaAsP/GaAs [53], GaAs/Si [53] และ SiGe/Si[53], เป็นต้น ลวดลายที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าเป็นผลจากรูปแบบการผ่อนคลายความเครียดที่สะสม อยู่เนื่องจากค่าคงตัวผลึกที่ไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถนำลวดลายตารางที่เกิดขึ้นมาใช้ในการจัดเรียงตัว ควอนตัมดอต ระบบที่ให้ความสนใจในที่นี้คือระบบ InGaAs/GaAs

2.3.2.2.1 ลักษณะโดยทั่วไป

ในระบบการปลูก InGaAs/GaAs ใช้ GaAs เป็นชั้นฐานและชั้น InGaAs เป็นตัวก่อความเครียด (stressor) ชั้นฐาน GaAs นิยมใช้กันมากขึ้นแทนซิลิคอนเนื่องจากมีสมบัติบางประการที่เหนือกว่า เช่น การเปล่งแสงและค่าความคล่องตัวทางไฟฟ้า [52] ส่วนชั้น InGaAs เป็นอัลลอยด์ที่เกิดจากการผสมสาร 3 ชนิด คือ In, Ga และ As คุณสมบัติโดยทั่วไปจะคาบเกี่ยวระหว่าง InAs และ GaAs กล่าวคือขึ้นอยู่กับ สัดส่วนของสาร In และ Ga ที่มาประกอบ ประโยชน์ที่สำคัญของการปลูก InGaAs บน GaAs คือความ ง่ายในการปลูกและคุณสมบัติที่ปรับเปลี่ยนได้



รูปที่ 2.9 แผนภาพแสดงการเกิดความเครียดแบบอัดเมื่อปลูกชั้น InGaAs บนชั้น GaAs

การปลูก InGaAs บน GaAs มีความสะดวก ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยในการปลูก เช่น ความเป็นขั้ว (polar on non-polar) หรือความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal expansion coefficient) การปลูกให้ได้ผลดีจึงทำได้ง่ายขึ้น ในเรื่องของคุณสมบัติ คุณสมบัติที่สำคัญ และปรับเปลี่ยนได้ของ InGaAs คือ ค่าคงตัวผลึกและค่าช่องว่างแถบพลังงาน

ค่าคงตัวผลึกเป็นค่าที่สำคัญต่อการเกิดลวดลายตาราง ค่าดังกล่าวใน InGaAs ขึ้นอยู่กับค่า สัดส่วนสาร In และ Ga และมีค่าอยู่ระหว่างค่าของ InAs และ GaAs (ประมาณ 6.0583 Åและ 5.6533 Å สำหรับ InAs และ GaAs ที่ 300 K ตามลำดับ) ตามสมการ [52]

$$a = 6.058 - 0.405(1 - x)$$
 (Å) 2.3

เมื่อ x คือ ค่าสัดส่วนของ In ใน In_xGa_{1-x}As ค่าแบนด์แกปสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน และเป็นไปดัง สมการ [52]

$$E_g = 0.36 + 0.505(1 - x) + 0.555(1 - x)^2 \quad (eV)$$
 2.4

ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.354 eV และ 1.424 eV ตามค่าซ่องว่างแถบพลังงานของ InAs และ GaAs ตามลำดับ จากสมบัติดังกล่าวส่งผลให้สามารถออกแบบได้ทั้งช่วงการเปล่งแสงและค่าความเครียด ชั้น InGaAs จึงเป็นชั้นที่มีความยืดหยุ่นมากในการกำหนดความเครียดและซ่องว่างแถบพลังงาน

2.3.2.2.2 กลไกการเกิดลายตาราง

การปลูก InGaAs บนชั้น GaAs ทำให้เกิดความเครียดขึ้นเนื่องจากค่าคงตัวผลึกที่ไม่เท่ากัน ใน ที่นี้ค่าคงตัวผลึกคือ 5.714 ^A ตามสัดส่วน In ที่ใช้คือ In_{0.15}Ga_{0.85}As ค่าความแตกต่างค่าคงตัวผลึกที่ เกิดขึ้นมีค่าประมาณ 1.07 % ซึ่งเป็นไปตามสมการ

$$\varepsilon = \frac{a_f - a_s}{a_s}$$
 2.5

a_f, *a_s* คือค่าคงตัวของชั้นฟิล์มและซับสเตรต ตามลำดับ ค่าความแตกต่างค่าคงตัวผลึกอาจเรียกอีก
 อย่างว่าความเครียดจากความไม่เข้ากัน (misfit strain) (*E*) การปลูกของชั้นผลึกในตอนแรกที่ความหนา
 ไม่มากนักเป็นแบบ 2 มิติแต่มีความเครียดสะสมอยู่ ความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นความเครียดแบบอัด
 เนื่องจาก In_{0.15}Ga_{0.85}As มีค่าคงตัวผลึกที่ใหญ่กว่าชั้น GaAs ดังแสดงในรูปที่ 2.9 ค่าความเครียดที่
 เกิดขึ้นจะถูกสะสมมากขึ้นตามค่าความหนาที่เพิ่มขึ้นจนถึงค่าๆหนึ่ง คือ ค่าความหนาวิกฤติ (h_{c60})
 สามารถคำนวณได้โดยอาศัยสมการจากแบบจำลองของ Matthews – blakeslee [52] คือ

$$H_{c60} = \frac{D(1 - v\cos^2\theta)(\ln(\frac{h_{c60}}{b}) + 1)}{Yf}$$
(2.6)

$$D = \frac{G_{GaAs}G_{InGaAs}b}{\pi(G_{GaAs}+G_{InGaAs})(1-\nu)}$$
(2.7)

$$G = C_{44} - \frac{1}{3} \left(2C_{44} + C_{12} - C_{11} \right)$$
(2.8)

$$b = \frac{\sqrt{2}}{2} a_{InGaAs}$$
(2.9)

$$\nu = \frac{C_{12}}{C_{21} + C_{11}} \tag{2.10}$$

$$Y = C_{11} + C_{12} - 2\frac{C_{12}^2}{C_{11}}$$
(2.11)

$$f = \frac{a_{InGaAs} - a_{GaAs}}{a_{InGaAs}}$$
(2.12)

เมื่อ heta = 60°, u คือ Poisson ratio, *G* คือค่า Anisotropic factor, *C* คือค่า Elastic constant และ *Y* คือค่า Young's modulus

จากสมการที่ 2.6 โดยสมมติให้ค่าคงที่ยืดหยุ่น (elastic constant)(C) มีค่าคงที่โดย เปลี่ยนแปลงแบบเชิงเส้นตามค่าสัดส่วน In ใน In_{1-x}Ga_xAs ทำให้สามารถสร้างเป็นกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาวิกฤติกับค่าสัดส่วนของ In(x) ในIn_{1-x}Ga_xAs ได้ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ค่าความหนาวิกฤติที่คำนวณได้สำหรับ In_{0.15}Ga_{0.85}As จากสมการที่ 2.6 มีค่าประมาณ 10 nm ค่า ความเครียดที่สะสมอยู่ในรูปของพลังงานความเครียดยืดหยุ่น (elastic strain energy) จะถึงจุดอิ่มตัว และเริ่มผ่อนคลายบางส่วนที่ความหนานี้ ก่อให้เกิดแนวของ dislocation ขึ้นซึ่งเป็นชนิดที่เราสนใจเพราะ ก่อให้เกิดลายตารางบนผิวหน้าและควบคุมได้ การเพิ่มความหนาของชั้นที่เกินกว่าค่าความหนาวิกฤติ มากเกินไป ระบบจะเกิดการคลายตัวอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิด dislocation ใหม่ เป็นชนิดที่เกิดจากการ เพิ่มทวีคูณ (multiplication dislocation) ซึ่งเป็น dislocation ที่ควบคุมได้ยาก



ฐปที่ 2.10 กราฟแส<mark>ดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาวิกฤติ</mark> (h_{.co})กับค่าสัดส่วน In(x) ใน

In_{1-x}Ga_xAs ตามสมการที่ 2.6

แนวของ dislocation ที่เกิดขึ้นในตอนแรกคือ misfit dislocation จะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของ ชั้นสารทั้งสอง misfit dislocation ในเริ่มแรกจะปรากฏในทิศทาง ± [110] และทิศทาง ± [-110] [53,54] ซึ่งเมื่อ dislocation ทั้งสองเคลื่อนที่ตัดกันอาจทำให้เกิดแนว dislocation ใหม่ขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของ การรวมกันว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดพลังงานยึดหยุ่น (elastic energy) เมื่อความหนาของชั้น InGaAs เพิ่มขึ้นอีก misfit dislocation จะมีจำนวนและความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 60° type misfit dislocation และ pure edge dislocation ทั้งสองชนิดแตกต่างกันตามลักษณะของการ เคลื่อนที่และผลของการเลื่อนระนาบ กล่าวคือ 60° type dislocation จะเคลื่อนตัวในระนาบ {111} และ ส่งผลการเลื่อนระนาบในทิศทาง <110> ในขณะที่ edge dislocation จะเคลื่อนตัวในระนาบ {100} และ ส่งผลการเลื่อนของระนาบในทิศทาง <111> dislocation ทั้งสองชนิดจะเกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ misfit strain ที่เกิดขึ้นในระบบบ โดย 60° type misfit dislocation จะพบได้ในระบบที่มีค่า misfit strain ต่ำ (≤ 2%) [54,55] ในขณะที่ pure edge dislocation จะเกิดขึ้นขัดเจนในระบบการปลูกที่มีค่า misfit strain สูง (≥ 3%) [55] misfit dislocation เหล่านี้บางส่วนเท่านั้นที่จะพัฒนาต่อไปเป็น Threading dislocation [53] ซึ่งเคลื่อนที่ต่อไปในเนื้อของวัสดุ



ิ พูนยวทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางก่อนบริเวณอื่น ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตขึ้นในสองทิศทางตามแนวของลาย ตารางนั่นเอง



รูปที่ 2.12 ลักษณะเวกเตอร์การเคลื่อนที่ของ dislocation ที่ทำให้เกิด up step และ down step โดยเมื่อ โปรเจค เวกเตอร์ในทิศทาง [110] โดย $\vec{b} = \frac{1}{2}$ [10-1] ทำให้เกิดการเลื่อนในระนาบ (1-11) เกิด downstep และ $\vec{b} = \frac{1}{2}$ [0-11] ทำให้เกิดการเลื่อนในระนาบ (-111) เกิด up-step [57]



รูปที่ 2.13 ขั้นตอนการเกิด surface step elimination โดยเรียงจาก ก) ขณะเริ่มเกิด surface step ขึ้น จาก dislocation ข) ลักษณะของชั้นฟิล์มเมื่อเกิดการเลื่อนของผลึกจาก dislocation ค) ลักษณะการก่อ ตัวของชั้นฟิล์มจากการเลือกเกิดบริเวณขอบของ step ก่อนบริเวณอื่น จนเกิดการหล่นลงมาของชั้นผลึก เมื่อมีความหนามากพอ ง) ผิวหนารูปแบบของลายตารางที่สมบูรณ์โดยพื้นผิวมีความโค้งและเรียบ [56]

2.3.3.2.3 การปรับปรุงลายตารางของโครงสร้าง In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs โดยการใช้ GaAs Spacer layer

การจัดเรียงควอนตัมดอตโดยใช้ลวดลายตารางบนโครงสร้าง InGaAs/GaAs ทำให้เกิดการ จัดเรียงตัวของควอนตัมดอตขึ้นจริง แต่มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ด้านการเปล่งแสง



รูปที่ 2.14 แสดง ก) ลักษณะของโครงสร้าง GaAs/In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ซึ่งมีลักษณะคล้ายบ่อ ควอนตัมแคบๆ ข) แสดงลักษณะการถูกบีบบังคับจาก GaAs ทั้งสองด้านของชั้น InGaAs เนื่องจาก ความไม่เข้ากันของโครงผลึก

หรือการนำไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจากลายตารางที่เกิดขึ้นเป็นผลจาก dislocation โดยตรง จึงเป็นการยากที่ จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากดังกล่าว ในหัวข้อนี้จึงนำเสนออีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อลดผลกระทบของ dislocation ในโครงสร้างลายตาราง InGaAs/GaAs

การกลบทับด้วยชั้นของ GaAs หรือการเพิ่มชั้น GaAs spacer บนชั้นของโครงสร้าง InGaAs/GaAs เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ลดผลของ dislocation ที่เกิดขึ้น การกลบทับด้วย GaAs ที่มีความหนา อย่างเหมาะสมทำให้เกิดโครงสร้างที่มีการบีบเค้นทั้งสองด้านในลักษณะคล้ายๆบ่อ (well) ดังแสดงในรูป ที่ 2.14 ถึงแม้การปลูกชั้น InGaAs ที่มีความหนาพอเหมาะจะทำให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด บางส่วนและก่อให้เกิด dislocation ขึ้นก็ตาม แต่แนวของ threading dislocation จะถูกบังคับให้วิ่งออก จากแนวเดิมหรือหยุดนิ่งในชั้นความเครียดขณะทำการกลบทับ โดยมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผ่านขึ้นไปยัง ด้านบน ดังแสดงในรูปที่ เป็นภาพ TEM ของกลุ่ม Z.G.Wang [58] ของโครงสร้าง In_{0.3}Ga_{0.7}As/GaAs ที่ มีการกลบทับด้วย GaAs หนา 10 และ 100 nm จะเห็นได้ว่าแนวของ dislocation ลดลงในหนึ่งแนวเมื่อ มีการกลบทับด้วย GaAs ที่หนา



รูปที่ 2.15 ภาพ bright-field พร้อมกับลูกศรบ่งชี้ทิศทางตามระนาบของชิ้นงานที่ถูกตัดขวาง โดย ภาพประกอบด้วย GaAs/In_{0.3}Ga_{0.7}As/GaAs ที่มีชั้นกลบทับ GaAs ที่มีความหนา ก) 10 nm และ ข) 100 nm [58]



ิ พูนยวทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
็นอกจากนี้ความสามารถในการลดแนวของ dislocation ลงในหนึ่งทิศทางของชั้น GaAs Spacer ยังมีความเป็นไปได้ที่ทำแม่พิมพ์สำหรับการเรียงควอนตัมดอตในแนวเดียว ตัวอย่างเช่นในกลุ่ม ของ Kwang Moo Kim [60] ที่มีการปลูกชั้น GaAs spacer บนโครงสร้าง (InAs/GaAs Superlattice (SL)) /GaAs ซึ่งเป็นโครงสร้างเครียดรูปแบบหนึ่ง ดังปรากฏในรูปที่ 2.17 เมื่อจำนวน cycle ของ ชั้น SL มีค่าน้อย (10 cycles) (รูปที่ 2.17 ก)) ซึ่งหมายถึง ค่าความหนาของชั้นความเครียดยังไม่เลยค่า ความหนาวิกฤติ แนวของ dislocation จึงยังไม่ปรากฏให้เห็น การก่อตัวของควอนตัมดอตจึงเป็นแบบสุ่ม ้ไม่เป็นระเบียบ แต่เมื่อจำนวนของชั้น SL เพิ่มมากขึ้น (15 cycles) ดังเช่นในรูปที่ 2.17 ข) ค่าความหนา จะมีค่าเกินค่าความหนาวิกฤติ แนวข<mark>อง dislocation เริ่มป</mark>รากฏให้เห็นเพียงบางส่วนเนื่องจากการผ่อน คลายเพียงบางส่วนของโครงสร้<mark>าง ควอน</mark>ตัมดอตจ<mark>ะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเนื่องจากมีแนวของ</mark> dislocation เป็นแม่พิมพ์ในก<mark>ารก่อตัว ซึ่งบริ</mark>เวณดังก<mark>ล่าวเป็นบริเวณ</mark>ที่มีพลังงานต่ำและเหมาะแก่การก่อ ้ตัวของควอนตัมดอต โดย<mark>แนวของควอนตัมดอตจะเรียงตัวในทิศทาง</mark> [110] มากกว่าในทิศทาง [1-10] เนื่องจากความหนาแน่นแนวของเนินในแนว [110] มากกว่า [1-10] และสำหรับกรณีของความหนา มากกว่าค่าความหนาวิกฤ<mark>ติประมาณ 3 เท่า (30 cycles) แนวของเ</mark>นินที่มีความหนาจะปรากฏให้เห็น บริเวณผิวหน้าและควอนตัมดอ<mark>ตจะก่</mark>อตัวบร**ิเวณแน**วเน<mark>ิน เหล่านั้น</mark> ดังแสดงในรูปที่ 2.17 ค) ซึ่งหาก พิจารณาในรูปที่ 2.17 ข) และ รูปที่ 2.17 <mark>ค) แนวการเรี</mark>ยงตัว<mark>ของคว</mark>อนตัมดอตจะเรียงตัวอย่างชัดเจนใน ์ แนว [110] และ [1-10] เท่านั้น จากผ<mark>ลการทดลองจึงเห็นไ</mark>ด้ว่า ถ้าความหนาของชั้น GaAs spacer ที่ ้เหมาะสมรวมกับชั้นความเครียดที่มีความหนาพอเหมาะมีโอกาสทำให้เกิดควอนตัมดอตที่มีการเรียงตัว แบบเส้นในแนวเดียว รูปแบบการจัดเรียงตัวใหม่ดังกล่าวจะถูกศึกษาเช่นกันในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้



รูปที่ 2.17 ลักษณะของผิวหน้าเมื่อทำการปลูก InAs QDs บนชั้นความเครียด เมื่อมีจำนวของชั้น SL

ก) 10 nm ข) 15 nm และ ค) 30 nm [60]

บทที่ 3

รายละเอียดการทดลอง

รายละเอียดการทดลองที่จะอธิบายในบทนี้ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เอพิแทกซีแบบลำโมเลกุล (Molecular beam epitaxy) และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวัดและวิเคราะห์ผล โดยจะอธิบายการทำงานของเครื่องมือต่างๆโดยละเอียด พร้อมกันนี้ยังแสดงขั้นตอนทั้งหมดที่กระทำ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 เอพิแทกซีแบบลำโมเลกุล (Molecular beam epitaxy) (MBE)

เอพิแทกซีแบบลำโมเลกุลหรือ MBE เป็นเครื่องมือปลูกชั้นฟิล์ม (film) บางที่ทันสมัยและมีความ ยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกใช้สารในกระบวนการได้อย่างหลากหลาย กระบวนการปลูกทั้งหมดควบคุมโดย เครื่องมือที่มีความแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์สภาพผิวหน้ารวมถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างทันที

3.1.1.1 หลักการทำงาน



รูปที่ 3.1 ก) ภาพตัดขวางแสดงส่วนประกอบภายในห้องปลูกผลึก และ ข) หลักการทำงานโดย คร่าวของเครื่อง MBE [61]

ภายในเครื่องดังแสดงในรูปที่ 3.1 ก) ประกอบไปด้วยเบ้าหลอมเล็กๆที่บรรจุสาร สารแต่ละชนิด ที่ถูกบรรจุอยู่ในเบ้าหลอมจะถูกเลือกและกำหนดอุณหภูมิอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดลำโมเลกุลของสาร เมื่อทำการปลูกสารในลักษณะของลำโมเลกุลจะถูกปล่อยออกไปยังซับสเตรตภายใต้สภาวะสุญญากาศ อะตอมหรือโมเลกุลของสารเมื่อไปถึงซับสเตรตอะตอมของสารจะเกิดการเคลื่อนที่และถ่ายเทพลังงาน จลน์ (kinetic energy) บนผิวหน้าซับสเตรต จากนั้นเมื่อพลังงานลดลง จะเกิดการก่อตัวบริเวณ nucleation site ทำให้เกิดชั้นฟิล์มบางของสารขึ้นบนซับสเตรตดังในรูปที่ 3.1 ข) โดยชั้นฟิล์มที่เกิดขึ้นมี อัตราการเกิดที่ช้ามาก (ในหน่วย ML/s) ทำให้สามารถควบคุมความหนาได้อย่างแม่นยำและชั้นของสาร ที่ได้มีความเรียบสูง

3.1.1.2 ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่อง MBE

ชิ้นงานที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทั้งหมดจะปลูกโดยเครื่อง RIBER 32P solid source MBE ระบบโดยทั่วไปของเครื่องเมื่อมองจากภายนอกประกอบไปด้วย 4 ห้อง (chamber) เชื่อมติดกัน ได้แก่ ห้องบรรจุ (Loading chamber), ห้องอินโทรดักซัน (Introduction chamber), ห้องส่งผ่าน (Transfer chamber) และ ห้องปลูก (Growth chamber) ดังแสดงในรูปที่ 3.2 ทั้ง 4 ห้อง มีหน้าที่ที่สำคัญดังนี้



รูปที่ 3.2 ก) ภาพถ่าย และ ข) โครงสร้างระบบปลูกผลึกของเครื่องปลูกลำโมเลกุล RIBER รุ่น 32P

ห้องบรรจุ (Loading chamber)

เป็นทางเข้าออกของชิ้นงานจากภายนอกสู่ตัวเครื่อง ในห้องนี้ประกอบไปด้วยวาล์วก๊าซ ในโตรเจน (Nitrogen gas valve) และปั้มโมเลกุลเทอร์โบ (Turbo molecular pump) แยกกันทำงานตอน นำเข้าหรือนำออกของชิ้นงานจากตัวเครื่อง สำหรับวาล์วก๊าซไนโตรเจนทำห้องหน้าที่เปิดให้ก๊าซ ในโตรเจนเข้าสู่ห้องบรรจุเพื่อปรับความดันให้เท่ากับภายนอก ซึ่งจะใช้งานเมื่อต้องการเปิดฝาของห้อง บรรจุออกสู่ภายนอก สำหรับปั้มโมเลกุลเทอร์โบจะใช้หลังจากปิดฝาห้องบรรจุหลังจากเชื่อมต่อจาก ภายนอก ปั้มโมเลกุลเทอร์โบจะทำหน้าที่ดูดอากาศออกจากห้องบรรจุเพื่อปรับความดันให้เหมาะสมก่อน จะเปิดเชื่อมต่อกับห้องอินโทรดักซันซึ่งอยู่ติดกัน ปั้มโมเลกุลเทอร์โบมีลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบดัง แสดงในรูปที่ 3.3 ประกอบไปด้วยโรเตอร์ (rotor) และ สเตเตอร์ (stator) ประกบคู่กัน ขณะทำงานเครื่อง จะดูดก๊าซหรืออากาศเข้าไปในเครื่อง โรเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยไปใบพัดเล็กๆจำนวนมากจะเพิ่ม โมเมนตัม (momentum) ให้กับโมเลกุลของก๊าซที่ดูดเข้าไป โมเลกุลของก๊าซจึงมีความเร็วมากขึ้นเมื่อผ่าน



ๆ นยาทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แท่นวางชิ้นงานยังสามารถหมุนได้ 360° ผ่านทางมอเตอร์ (motor) การหมุนของชิ้นงานเป็นไปเพื่อให้ลำ โมเลกุลของสารตกใส่ผิวของชิ้นงานได้อย่างสม่ำเสมอ ที่บริเวณด้านหน้าของตัวจัดแนวยังมีแผ่นชัตเตอร์ สามารถปิดได้เมื่อไม่ต้องการให้ลำโมเลกุลตกกระทบชิ้นงาน



รูปที่ 3.4 ลักษณะทั่วไปของซับสเตรตมานิพูเลเตอร์ [63]

2. Effusion cell

เป็นที่บรรจุสารที่ใช้ในการปลูก เช่น Ga, In และ As ในรูปของของแข็ง เมื่อใช้งานสารที่ บรรจุอยู่จะถูกทำให้ร้อนขึ้นด้วยขดลวดนำความร้อนที่พันอยู่รอบๆ จากของแข็งสารจะระเหิด เปลี่ยนตัวเองเป็นไอ ไอที่เกิดขึ้นจะถูกบังคับให้ออกสู่ภายนอกในช่องทางเล็กๆ เกิดเป็นลักษณะ ของลำโมเลกุลของสารซึ่งใช้ในการปลูกต่อไป ภายในห้องการปลูกมี Effusion cell มีทั้งหมด 9 เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์จะมีชัตเตอร์ (shutter) กั้นเพื่อป้องกันสารลอดออกมาขณะยังไม่ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ลักษณะทั่วไปของ Effusion cell [64]

3.1.1.3 ระบบสุญญากาศ

การทำงานของเครื่อง MBE จำเป็นต้องทำงานภายในระบบสุญญากาศ ทุกห้องยกเว้นห้องบรรจุ จะมีระบบปั้มควบคุมให้ภายในเป็นสุญญากาศ ระบบปั้มดังกล่าวมี 2 ชนิดทำงานร่วมกัน ได้แก่

- ปั้มระเหิดไทเทเนียม (Titanium sublimation pump) ทำงานโดยการปล่อยกระแส ใฟฟ้าแรงสูง (ประมาณ 40 Amps) แบบเป็นคาบๆไปยังขดลวดไทเทเนียม (titanium) ด้วย กระแสไฟฟ้าดังกล่าวทำให้ไทเทเนียมบางส่วนบนขดลวดระเหิดออกมาปกคลุมรอบๆห้อง ไทเทเนียมที่ระเหิดออกมาจะมีคุณสมบัติที่ไวต่อปฏิกิริยาโดยเฉพาะกับก๊าซที่หลงเหลืออยู่ ในห้อง ซึ่งไทเทเนียมจะไปจับกับก๊าซดังกล่าวแล้วเกิดเป็นสารประกอบของของแข็ง ซึ่งมีผล ในการลดความดันในห้องต่างๆ
- 2. ไอออนปั้ม (Ion pump) เป็นปั้มอีกชนิดหนึ่ง ทำงานโดยทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออน จากนั้นจึงใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 3-7 kV กวาดไอออนของก๊าซดังกล่าวไปยังแท่ง ขั้วไฟฟ้า ทำให้ก๊าซในห้องลดน้อยลงไอออนปั้ม โดยทั่วไปสามารถทำให้เกิดสุญญากาศใน ห้องได้ในระดับ 10⁻¹¹ mbar

3.1.2 In-situ measuring Equipment

ในการปลูกผลึกโดยเครื่อง MBE จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะและ สถานะโดยรวมของการปลูกที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือเหล่านั้นจะติดตั้งภายในเครื่อง MBE เครื่องมือ เหล่านั้นได้แก่ ระบบวัดความดัน, Reflection high-energy electron diffraction (RHEED) และ Quadrupole mass spectrometer

3.1.2.1 ระบบวัดความดัน

ความดันภายใน chamber ต่างๆสามารถวัดได้โดยการใช้ hot filament ionization gauge เกจ (gauge) ชนิดนี้มีความว่องไวต่อการวัดความดันมากในระดับ 10⁻³- 10⁻¹¹ Torr ซึ่งเหมาะสมกับความดัน ภายในเครื่อง MBE ตัวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย แท่งโลหะแคโทด 3 ชนิด ได้แก่ คอลเลกเตอร์ (collector), ฟิลาเมนต์ (filament) และกริด (grid) ดังแสดงในรูป 3.6 ตัวเกจจะทำงานโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไป ยังฟิลาเมนต์เพื่อปล่อยอิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะถูกดึงดูดโดยแท่งกริดซึ่งเรียงตัวคล้าย เกลียว ระหว่างทางที่อิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะถูกดึงดูดโดยแท่งกริดซึ่งเรียงตัวคล้าย เกลียว ระหว่างทางที่อิเล็กตรอนจะเข้าไปยังแท่งกริด อิเล็กตรอนจะชนกับก๊าซที่อยู่รอบๆตัวเกจ ทำให้ ก๊าซเหล่านั้นแตกตัวเป็นไอออน ไอออนของก๊าซเหล่านั้นเนื่องจากมีประจุหรือไอออนจะถูกดึงดูดโดยแท่ง คอลเลกเตอร์ตรงกลางซึ่งถูกทำให้เป็นประจุลบ เมื่อไออนของก๊าซเหล่านั้นมาถึงแท่งคอลเลกเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นซึ่งมีค่ามากน้อยตามค่าความดันของก๊าซรอบตัวเกจ จากนั้นจึงนำกระแสไฟฟ้าที่ ได้ไปขยายและแปลงเป็นค่าความดันแสดงผลต่อไป นอกจากวัดค่าความดันทั่วไปในห้องต่างๆ แล้ว hot filament ionization gauge ยังใช้เป็นตัวอ้างอิงค่าฟลักซ์ (flux) ของลำโมเลกุลของสารที่ถูกปล่อยออกมา จากเซลล์ขณะปลูกอีกด้วย



รูปที่ 3.6 ลักษณะทั่วไปของ hot filament ionization gauge ประกอบไปด้วยแท่งโลหะ 3 ชนิด ฟิลาเมนต์, กริด และคอลเลกเตอร์ [65]

3.1.2.2 Reflection high-energy electron diffraction (RHEED)

Reflection high-energy electron diffraction หรือ RHEED เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการ วิเคราะห์โครงสร้างผิวหน้า โดยการยิงลำอิเล็กตรอน ซึ่งสร้างโดยปืนอิเล็กตรอน (electron gun) ไปตก กระทบบนชิ้นงาน ดังรูปที่ 3.7 โดยลำอิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กจะเกิดการสะท้อนกับโครงสร้างผลึกของ ชิ้นงานในระดับอะตอม แสงสะท้อนที่เกิดขึ้นจะไปตกกระทบบนฉากฟอสฟอรัสและเกิดจุดสว่างขึ้น แต่ เนื่องจากโครงสร้างผลึกหรือผิวหน้าที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดการสะท้อนออกที่ไม่เท่ากัน แสงที่สะท้อน ออกมาจึงเกิดการแทรกสอด เกิดเป็นแถบมืดสว่างขึ้นบนฉากฟอสฟอรัสในรูปแบบเฉพาะตัว รูปแบบของ แถบมืดสว่างที่เกิดขึ้นจึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกโครงสร้างผลึกผิวหน้าได้



รูปที่ 3.7 โครงสร้างของระบบ RHEED [66]

3.1.2.3 Quadruple mass spectrometer

Quadruple mass spectrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณของสารชนิดต่างๆภายใน ห้องปลูก ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ตัวกำเนิดไอออน (ion source), ตัววิเคราะห์มวล (mass analyzer) และตัวตรวจจับ (detector) ประกอบกันตามรูปที่ 3.8 ก) การทำงานของเครื่อง เริ่มจากสารที่หลุดเข้าไป



ๆ นยาทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ๆ นยาทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 3.11 ภาพแสดงการทำงานอย่างง่ายของ AFM [70]

การวิเคราะห์สภาพผิวหน้าของขึ้นงานที่ได้จากการทดลองจะใช้เครื่อง SEIKO SPA 400-AFM (รูปที่ 3.10) ในโหมดแตะ (tapping) การทำงานของเครื่องจะประกอบไปด้วยคานยื่น (cantilever) ซึ่งตรง ปลายจะมีทิป (tip) แหลมขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 3.11 คานยื่นจะทำจากซิลิคอนหรือซิลิคอนไนไตรด์ (silicon nitride) ที่มีปลายแหลมขนาดเล็กมาก เมื่อหัวทิปกวาดผ่านผิวหน้าชิ้นงานที่มีความขรุขระ หัว ทิปจะมีการขยับไปตามลักษณะของผิวหน้าที่ตำแหน่งนั้นๆ การขยับของหัวทิปจึงบอกถึงลักษณะทาง กายภาพของผิวหน้าในบริเวณที่กวาดผ่าน ส่วนการแปลงเป็นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของผิวหน้านั้น จะใช้แสงเลเซอร์ยิงไปที่หัวทิปที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงเลเซอร์ได้ดี เมื่อหัวทิปมีการขยับตัวตรวจจับแสง (photodetector) จะตรวจจับความเข้มของแสงเลเซอร์ที่สะท้อนจากหัวทิปซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการ ขยับของหัวทิป ผลลัพธ์ที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมคือสามารถแสดงภาพลักษณะทางกายภาพ ของผิวหน้าชิ้นงานจริงซึ่งมีขนาดเล็กมากได้ พร้อมทั้งบ่งบอกข้อมูลวัดที่สำคัญบางตัว เช่น ความสูง

3.3 การเตรียมชิ้นงาน

การเตรียมชิ้นงาน เริ่มต้นจากการติดซับสเตรตซึ่งในที่นี้คือ GaAs (100) บนโมลิบดีนัมบล็อก (molybdenum block) ด้วยกาวอินเดียม จากนั้นจึงโหลด (load) ชิ้นงานเข้าเครื่องผ่านทางห้องบรรจุ โดยบั้มโมเลกุลเทอร์โบที่ติดอยู่กับห้องบรรจุจะทำงานเพื่อปรับให้มีความดันและสภาวะสุญญากาศที่ เหมาะสมจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายชิ้นงานต่อไปยังภายในห้องอินโทรดักซัน ชิ้นงานจะผ่านกระบวนการทำ ความสะอาดเบื้องต้นหรือที่เรียกว่า "pre-heat" กระบวนการ pre-heat จะเริ่มต้นจากการให้ความร้อน ชิ้นงานในอัตราคงที่จนถึง 450 °C จึงทิ้งค้างที่อุณหภูมินี้ 1 ชั่วโมงจากนั้นจึงค่อยๆลดลงด้วยอัตราใน ลักษณะเดิมกับที่เพิ่มขึ้นจนถึง 30°C ดังแสดงในรูปกราฟที่ 3.12 เมื่อชิ้นงานผ่านกระบวนการ pre-heat จะมีความสะอาดในระดับหนึ่ง จากนั้นจึงส่งชิ้นงานต่อไปยังห้องส่งผ่านและห้องปลูก ตามลำดับ

ภายในห้องปลูกขึ้นงานจะผ่านกระบวนการเตรียมผิวหน้าก่อนที่จะปลูกซึ่งเป็นชั้นตอนที่เรียกว่า ขั้นตอน "de-ox" ดังแสดงในรูปที่ 3.13 ชับสเตรตจะถูกให้ความร้อนด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ 30 °c/min จนถึง 300°C ชัตเตอร์ของเซลล์ As₄ จะถูกเปิดออกเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในบรรยากาศของไอ As₄ ซึ่ง ในที่นี้มีค่าประมาณ 8x10⁶ Torr หรือประมาณ 15-25 เท่าของค่าแรงดันไอ BEP (Beam Equivalent Pressure) มากที่สุดของลำโมเลกุลของธาตุหมู่ III ซึ่งในที่นี้คือแรงดันไอของ Ga ซึ่งใช้ปลูกชั้นบัฟเฟอร์ (3x10⁻⁷ Torr) อุณหภูมิของซับสเตรตยังถูกเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจนกระทั่งสังเกตเห็นลวดลายการเลี้ยวเบน (diffraction pattern) บนฉาก RHEED (RHEED screen) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นเมื่อออกไซด์ได้ หลุดออกจากผิวหน้าของขึ้นงาน ค่าอุณหภูมิดังกล่าว(T_{deox}) ซึ่งถูกวัดโดยเทอร์โมคัปเปิลจะถูกบันทึกเป็น อุณหภูมิอ้างอิงที่ 580°C ของผิวหน้าเพื่อใช้ในการปลูกชั้นบัฟเฟอร์ต่อไปจากนั้นจึงเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีก 30 °C และคงอุณหภูมิทิ้งไว้จนกว่าปริมาณออกไซด์ซึ่งแสดงโดย mass spectrometer จะลดลงถึงใน ระดับที่ยอบรับได้ จากนั้นจึงลดอุณหภูมิมาที่ T_{deox} ขั้นสุดท้ายจึงทำการปลูกบัฟเฟอร์ (buffer) ของ GaAs ความหนา 300 nm ที่อุณหภูมิ 580 °C หรือ T_{deox} ดังกล่าว เพื่อปรับพิ้นผิวให้มีความเรียบก่อนทำการ ปลูกจริง



รูปที่ 3.12 โพรไฟล์อุณหภูมิ (Temperature profile) ของกระบวนการทำ pre-heat



รูปที่ 3.13 โพรไฟล์อุณหภูมิของขั้นตอนการทำการ De-Ox พร้อมกระบวนการเปิดปิดชัตเตอร์

3.4 การวัดเทียบอุณหภูมิ

เนื่องจากค่าอุณหภูมิที่วัดได้โดย Thermocouple ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงของผิวหน้า substrate ทำให้จำเป็นต้องหาค่าอุณหภูมิดังกล่าวเพื่อใช้ในการปลูกอื่นๆ RHEED pattern เป็นวิธีหนึ่งที่ สามารถที่ใช้หาอุณหภูมิผิวหน้าของซับสเตรตได้โดยพิจารณาวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง RHEED pattern ที่อุณหภูมิใดๆมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิซับสเตรต ซึ่งจำเป็นต้องขึ้นกับความดันไอ As₄ในขณะนั้นด้วย ค่าอุณหภูมิที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง RHEED pattern คือค่าอุณหภูมิ Transition (T_{trans}) การหาค่า T_{trans} เริ่มต้นหลังจากปลูกบัฟเฟอร์ GaAs ที่อุณหภูมิ T_{deox}ซึ่งเทียบเท่าอุณหภูมิ 580 °C จากนั้นจึงเริ่มลด อุณหภูมิในช่วงแรกและเพิ่มอุณหภูมิในช่วงหลังกลับมาเท่าเดิมที่ T_{deox} ดังแสดงในรูปที่ 3.14 รูปแบบของ RHEED pattern จะเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน

ในช่วงแรก RHEED pattern จะปรากฏในรูปแบบ C(2x4) (รูปที่ 3.14 ก)) ซึ่งเป็นรูปแบบ RHEED ทั่วไปของชั้น GaAs หลังจากทำการปลูกบัฟเฟอร์ เมื่อเราทำการลดอุณหภูมิของซับสเตรต ลง อย่างคงที่ (10°C/min) RHEED pattern จะเปลี่ยนจาก C(2x4) เป็น รูปแบบในรูป 3.14 ข) ค่า T₁ จะถูก บันทึก หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิของซับสเตรต ลดลงอีก RHEED pattern จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ในรูป 3.14 ค) หรือ C(4x4) ค่าอุณหภูมิที่ได้ขณะนี้คือ T₂ ซึ่งเมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึง 450 °C อุณหภูมิจะถูกปรับให้สูงขึ้นในอัตราที่เท่ากันกับตอนที่ลดลง รูปร่างของ RHEED pattern จะเริ่ม



รูปที่ 3.14 ภาพ RHEED patterns ที่ได้จาก RHEED Screen ของการเปลี่ยนแปลง RHEED pattern จาก C(2x4) ไปเป็น C(4x4) ของพื้นผิว GaAs ในการหาค่าอุณหภูมิ transition โดยเรียงลำดับจากรูป ก-ฉ

เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งจนมาถึงอุณหภูมิ T₃ รูป RHEED pattern จะปรากฏในรูป 3.9 ง) และขั้นสุดท้ายเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจนถึงประมาณค่าที่ใช้ในการปลูกบัฟเฟอร์เดิม RHEED pattern จะเริ่ม เปลี่ยนกลับมาเช่นเดิมในรูปแบบ C(2x4)ในรูปที่ 3.14 จ) ที่อุณหภูมิ T₄ ค่า T₁,T₂,T₃ และ T₄ ที่ได้นั้นจะถูก นำมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าที่ได้จะถูกใช้อ้างอิงกับอุณหภูมิ 500 ^oC จากนั้นจึงปรับอุณหภูมิของซับสเตรตมา ที่อุณหภูมิ T_{deox} อีกครั้งเพื่อทำการปลูกบัฟเฟอร์และดำเนินขั้นตอนการปลูกในขั้นตอนต่อๆไป

3.5 การวัดเทียบอัตราการปลูก

ในการปลูกใดๆจำเป็นต้องทราบอัตราการปลูกของสารที่ใช้ เพื่อจะสามารถกำหนดความหนา และสัดส่วนของสารประกอบในแต่ละชั้นได้อย่างแม่นยำ อัตราการปลูกของ GaAs และ InAs สามารถหา ได้จากการพิจารณาความเข้มของการกระพริบใน RHEED

3.5.1 การหาอัตราการปลูกของ GaAs

ในการปลูก GaAs ซึ่งเป็นแบบ 2 มิติ หรือชั้นต่อชั้น มีวิธีการดังนี้คือหลังจากการทำการปลูกชั้น บัฟเฟอร์ของ GaAs แล้วปรับมาที่ค่าอุณหภูมิที่ต้องการปลูกพร้อมกับหยุดมอเตอร์แล้ว จึงทำการปรับ หมุนชิ้นงานด้วยมือจนได้ zero-order diffracted RHEED beam ที่มีความเข้มสูงสุด (รูปที่ 3.15) จากนั้น จึงทำการปลูกชั้นบัฟเฟอร์ของ GaAs ลงไปบนชิ้นงาน ซึ่งขณะทำการปลูกจะสังเกตเห็นภาพบน RHEED screen มีการแกว่ง (oscillate) การแกว่งไปมาที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.16 ซึ่งการแกว่ง 1 ครั้ง ประมาณเท่ากับความหนาชั้นบัฟเฟอร์ 1 Monolayer (ML) [71] ในการทำการวัดเทียบ (calibrate) จริงจะทำการจับเวลาที่ใช้ในการแกว่งของ RHEED screen 10 ครั้ง จากนั้นจึงนำเวลามาหาค่าอัตราการปลูกของ GaAs ที่ใช้ในขณะนั้นที่อุณหภูมิผิวหน้าดังกล่าว ดัง สมการ

อัตราการปลูก
$$GaAs = rac{10}{_{szezicanintia ilde{n} ilde{n}$$

ซึ่งถ้ายังไม่ได้ตามค่าที่ต้องการจะทำการวัดเทียบ ใหม่หรือใช้การประมาณแบบเชิงเส้นเข้าช่วย ในกรณีที่ค่าที่ต้องการอยู่ระหว่างช่วงหรื<mark>อค่าสองค่าที่ทำการวัด</mark>ได้



รูปที่ 3.15 ตำแหน่งของ zero-order diffracted RHEED (00) beam บน RHEED Screen



รูปที่ 3.16 ลำดับขั้นต่างๆของการเกิดเกาะสองมิติ (2D islands) ของการปลูกชั้นต่อชั้นของ SrTiO₃ และ ความเข้มของ zero-order diffracted RHEED beam ที่เปลี่ยนแปลงไป [72]

3.5.2 การหาอัตราการปลูกของ InAs

การหาอัตราการปลูกของ InAs จะแตกต่างจากของ GaAs ที่ต้องใช้การกระพริบ แต่สำหรับการ หาอัตราการปลูกของ InAs จะใช้การพิจารณารูปแบบของ RHEED pattern ที่เปลี่ยนไปแทน การวัด เทียบจะทำหลังจากการปลูกบัฟเฟอร์เหมือน GaAs แต่ไม่ต้องหยุดมอเตอร์ โดยหลังจากปรับอุณหภูมิ พื้นผิวมาที่อุณหภูมิที่ต้องการจะทำการปลูกชั้น InAs ขึ้นบนพื้นผิว GaAs ของชิ้นงาน หลังจากเวลาปลูก ผ่านไปสักพักจะเห็นรูปแบบของ RHEED Pattern ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปจาก streaky (2D) ไปเป็น spotty (3D) ซึ่งจะทำการจับเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบดังกล่าว (2D→3D) การ คำนวณหาอัตราการปลูกจะทำได้อาศัยหลักการที่ว่า เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ RHEED จาก 2 มิติ ไปเป็น 3 มิติ มีค่าเท่ากับปลูกได้ความหนา 1.7 ML [73] ดังนั้นอัตราการปลูกของ InAs จึงเท่ากับ

อัตราการปลูก
$$InAs = \frac{1.7}{szezะเวลาที่จับได้ทั้งหมด(sec)}$$
 (ML/s) (3.3)

3.6 การปลูกชั้นผลึก

ชั้นผลึกที่ปลูกเพื่อศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ชนิดตามโครงสร้างที่สนใจ ได้แก่ ชั้น บัฟเฟอร์ ชั้นลายตาราง ชั้น GaAs Spacer ชั้นควอนตัมดอต และชั้นกลบทับ แต่ละชั้นประกอบขึ้นจาก สารประกอบหลักๆชนิดใดชนิดหนึ่งจาก 3 ชนิดคือ GaAs, InGaAs และ InAs ทุกๆชั้นล้วนมีความสำคัญ และมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง การปลูกชั้นต่างๆมีความแตกต่างกันสามารถอธิบายได้ดังนี้คือ

3.6.1 ชั้นบัฟเฟอร์

ชั้นบัฟเฟอร์ เป็นชั้นผลึกของ GaAs ที่มีความหนา 300 nm ปลูกขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปรับสภาพ พื้นผิวของแผ่นฐาน GaAs เดิมให้มีความเรียบมากยิ่งขึ้นก่อนจะทำการปลูกชั้นต่อไป คุณสมบัติ โดยทั่วไปของชั้นคล้ายกับก้อนผลึก GaAs เนื่องจากเป็นชั้นที่มีความหนามากระดับหนึ่ง การปลูกชั้น บัฟเฟอร์ของ GaAs บนแผ่นฐาน GaAs ทำได้โดยการปล่อยไอของ Ga ออกจากเซลล์ของเครื่อง MBE ภายใต้บรรยากาศของ As₄ เมื่ออะตอมของ Ga ที่ปล่อยมาจากเซลล์มาถึงผิวหน้าชิ้นงาน ก็จะเกิดพันธะ กับอะตอมของ As เกิดเป็นอะตอมของสารประกอบ GaAs ใหม่เกาะบนผลึก GaAs เดิมบนแผ่นฐาน การปลูกชั้นบัฟเฟอร์กระทำที่อุณหภูมิพื้นผิว 580°C ที่อัตราการปลูก 0.6 ML/s

3.6.2 ชั้นลายตาราง

ชั้นลายตาราง (crosshatch layer) เป็นชั้นความเครียดที่เกิดจากการปลูกชั้นผลึก InGaAs ลง บนชั้นบัฟเฟอร์ GaAs ด้วยค่าคงตัวผลึกที่แตกต่างกันทำให้เกิดความเครียดขึ้นในระบบ ความไม่เข้ากัน โครงผลึก (ᢄ) ที่เกิดขึ้นในชั้นนี้ถูกออกแบบให้มีค่าน้อย (1.07%) โดยเลือกใช้สารที่มีค่าคงตัวผลึก แตกต่างจากชั้นบัฟเฟอร์ไม่มาก คือ In_{0.15}Ga_{0.85}As การเกิดชั้นผลึกจึงเป็นแบบสองมิติหรือรูปแบบ FM โดยตลอด

ความเครียดที่เกิดขึ้นในระบบแม้ว่าจะไม่พอที่สำหรับการเปลี่ยนการปลูกไปเป็น 3 มิติ แต่ทว่า ความเครียดสะสมที่มากขึ้นตามความหนาที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิด dislocation ขึ้นอันเป็นผลจากความ ต้องการลดความเครียดสะสมในระบบ dislocation ที่เกิดขึ้น ทำให้ผิวหน้าของชั้นสารเปลี่ยนแปลงไป เป็นรูปลายตารางไว้ใช้ในการจัดเรียงตัวควอนตัมดอต ซึ่งได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 2 (หัวข้อที่ 2.3.2.2.2) เนื่องจากลายตารางเกิดจากการคลายตัวของพลังงานความเครียดในระบบเมื่อชั้นมีความ หนามากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ลายตารางดังที่ต้องการจำเป็นต้องกำหนดความหนาของชั้นให้เหมาะสมโดย พิจารณาจากค่าความหนาวิกฤติเป็นสำคัญ ความหนาของชั้นลายตารางที่ดีควรมีค่าอยู่ระหว่างค่าความ หนาวิกฤติ (h_c) และค่าความหนาทวีคูณ (h_c) ซึ่งมีค่า 10 nm และ 76 nm [33] ตามลำดับ ความหนา ในช่วงดังกล่าวเป็นความหนาที่สามารถควบคุมลักษณะการเกิดของลายตารางบนผิวหน้าได้ ความหนา ของชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As ที่ใช้คือ 50 nm จึงเป็นความหนาของชั้นที่เหมาะสมและก่อให้เกิดลายตารางที่ ควบคุมได้

กระบวนการปลูกชั้นลายตารางของ InGaAs บน GaAs ใช้วิธีการเปิดม่านชัตเตอร์ของเซลล์ In และ Ga พร้อมกันภายใต้บรรยากาศของ As₄ ที่ 500°C หรือ T_{trans} ทำให้เกิดเป็นชั้น InGaAs ขึ้น แต่ต้อง คำนึงอัตราส่วนของ In ต่ออัตราส่วนของ Ga ซึ่งควรมีค่าไม่มากเกินไปตามสัดส่วนที่ได้จากการคำนวณ โดยเปิดทิ้งไว้จนได้ความหนาตามต้องการ (จากการคำนวณร่วมกับการวัดเทียบ (calibrate)) จากนั้น จึง ปิดม่านชัตเตอร์ของเซลล์ In และ Ga ทันที ส่วน As₄ ให้เปิดทิ้งไว้ตามปกติ ก็จะได้ผิวหน้าที่เป็นชั้นลาย ตารางที่ต้องการ

3.6.3 ชั้น GaAs spacer

ชั้น GaAs spacer เป็นชั้นที่ใช้ในการปรับปรุงแผ่นฐานเสมือนลายตารางในเรื่องของ dislocation ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ลักษณะการปลูกคล้ายกับการปลูกชั้นบัฟเฟอร์ คือการปล่อยลำ โมเลกุลของ Ga ภายใต้บรรยากาศของ As₄ ไปบนผิวหน้าของชิ้นงาน แต่จะกระทำที่อุณหภูมิ 500 °C แทน 580 °C เพื่อที่จะสร้างชั้นของ GaAs แต่มีอัตราการปลูกที่ช้ากว่า (0.1 ML/s) ในส่วนของชั้นนี้จะมี การปรับแต่งในเรื่องของความหนาของชั้นเป็นสำคัญ

3.6.4 ชั้นควอนตัมดอต

ชั้นควอนตัมดอตเป็นชั้นที่เกิดขึ้นจากการปลูก InAs ลงบนแผ่นฐานในโหมดการปลูกแบบ SK โดยแบ่งออก 2 ชนิดคือ SK ปกติ และ SK แบบ Migration Enhance Epitaxy (MEE) ซึ่งทั้งสองชนิด แตกต่างกันตามลักษณะการเปิดปิดชัตเตอร์สาร In และสาร As ขณะปลูกควอนตัมดอต ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ในการปลูกควอนตัมดอตชนิด SK แบบปกติ ชัตเตอร์ของ In และ As จะถูกเปิดอยู่ตลอดเวลาขณะ ปลูก แต่การปลูกใน SK แบบ MEE ชัตเตอร์ของ In และ As จะถูกเปิดปิดสลับกัน การปลูกในแบบ SK ทั้งสองมีเงื่อนไขการปลูกที่เหมือนกัน ดังแสดงแผนภาพสภาวะสมดุลในรูปที่ 3.18 คือต้องทำให้ **ɛ** และ H (ความหนาวิกฤติ) อยู่ในช่วง SK, หรือ SK, โดยจะให้อยู่ในช่วง SK, เป็นสำคัญ





การเกิดควอนตัมดอตแบบ SK₁ จะเกิดขั้นของสารใน 2 มิติก่อนคือมี Wetting layer หนา ปริมาณหนึ่งก่อน จากนั้นการปลูกจึงจะเปลี่ยนเป็นแบบ 3 มิติ และเริ่มเกิดควอนตัมดอตขึ้นในที่สุด การ สังเกตการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือการเกิดควอนตัมดอตสามารถกระทำได้โดยอาศัยภาพจาก RHEED เป็นตัวตัดสินใจ

ลักษณะภาพของ RHEED ขณะเปลี่ยนแปลงควอนตัมดอต ดังแสดงในรูปที่ 3.19 โดยเริ่มแรก ขณะเปลี่ยนจากโหมดการปลูกจาก 2 มิติไปเป็น 3 มิติ ภาพของ RHEED จะเปลี่ยนจาก streaky pattern ไปเป็น spotty pattern หลังจากนั้นเมื่อสังเกตบริเวณใกล้กับ Specular beam ตรงที่ลูกศรชี้ในรูปที่ 3.19 ก) จะเริ่มเห็นจุดสว่างขึ้นมา จุดสว่างดังกล่าวแสดงให้รู้ว่าควอนตัมดอตเริ่มเกิดขึ้นบ้างบนผิวหน้า ซึ่งถ้า หากปลูกควอนตัมดอตต่อไป ควอนตัมดอตจะเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและขนาดยิ่งใหญ่ขึ้นผลที่ได้คือ ลักษณะภาพของ RHEED pattern จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะสังเกตเห็น Chevron pattern ลางๆ เกิดขึ้น (รูปที่ 3.19 ข)) โดยชัดเจนมากขึ้นเมื่อทำการปลูกต่อไปเรื่อยๆดังปรากฏในรูปที่ 3.19 ค) แสดงถึง การมีควอนตัมดอตอยู่มากบนผิวหน้า Chevron pattern เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของภาพ RHEED ที่แสดงให้



ๆ นยาทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ๆ นยาทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ควอนตัมดอตที่ปลูกบน In_{0.85}Ga_{0.15}As/GaAs จะมีการจัดเรียงในทิศ [110] และทิศ [1-10] ซึ่ง สอดคล้องกับแนวของ dislocation ด้านล่าง การเพิ่มชั้น GaAs spacer บนลายตารางส่งผลให้ลาย ตารางที่ปรากฏบนพื้นผิวเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ควอนตัมดอตที่ปลูกบนพื้นผิวดังกล่าวมีการจัดเรียงตัว ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ในบทนี้จะอธิบายผลการทดลองการปลูกควอนตัมดอตบนแม่แบบ GaAs/In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs เมื่อความหนาของชั้น GaAs spacer เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมุ่งเน้นผลการศึกษาสมบัติของพื้นผิวและ การเปล่งแสงของชิ้นงาน

4.1 โครงสร้างของชิ้นงาน

โครงสร้างของชิ้นงานทั้งหมดที่ปลูกขึ้นถูกแสดงในภาพตัดขวางดังรูปที่ 4.1 พร้อมกับแสดง รายละเอียดต่างๆในตารางที่ 4.1



x = 50,100 และ 250 nm

รูปที่ 4.1 ภาพตัดขวางของชิ้นงานในการทดลอง ก) โครงสร้างสำหรับศึกษาสมบัติทางกายภาพของ ผิวหน้าด้วยเทคนิค AFM ข) โครงสร้างสำหรับศึกษาสมบัติทางแสงด้วยเทคนิค PL

การปลูกขึ้นงานเริ่มต้นจากแผ่นฐาน (100) - GaAs หลังจากผ่านกระบวนการเตรียมผิวหน้า ชิ้นงานจะถูกปลูกชั้น GaAs บัฟเฟอร์หนา 300 nm ที่อุณหภูมิผิวหน้า 580 °C เพื่อให้ผิวหน้าเรียบ จากนั้นจึงลดอุณหภูมิลงมาที่ 500 °C เพื่อปลูก In_{0.15}Ga_{0.85}As ความหนา 50 nm ตามด้วยชั้น GaAs spacer หนา 50, 100 หรือ 250 nm สำหรับชิ้นงาน A, B และ C ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการก่อ ตัวของควอนตัมดอต จากนั้นจึงปลูกชั้น InAs ควอนตัมดอต หนา 1.8 ML ในแบบ SK ปกติ และ SK แบบ MEE ซึ่งจะแตกต่างกันในรูปแบบการเปิดปิดชัตเตอร์สาร In และ As ขณะปลูกควอนตัมดอตดังที่ได้ กล่าวถึงในบทที่ 3 โดยหลังจากที่ควอนตัมดอตก่อตัวขึ้น ชัตเตอร์ In จะปิดลงแล้วคงอุณหภูมิปลูกไว้เป็น เวลา 30 วินาที จากนั้นสำหรับชิ้นงานที่ใช้ศึกษาสมบัติของพื้นผิว ดังโครงสร้างที่ 4.1 ก) อุณหภูมิแผ่น ฐานจะถูกปรับลงมายัง 100°C ทันทีเพื่อรักษารูปร่างของควอนตัมดอต [76] ส่วนชิ้นงานที่ใช้ใน การศึกษาสมบัติทางแสงดังโครงสร้างในรูปที่ 4.1 ข) ควอนตัมดอตจะถูกกลบทับด้วย GaAs หนา 100 nm ก่อนแผ่นฐานจะถูกลดอุณหภูมิลงมายัง 100°C ลักษณะของชิ้นงานต่างๆที่ใช้ในการศึกษาถูกสรุป ในตารางที่ 4.1 ชิ้นงานสำหรับศึกษากายภาพของผิวหน้า ได้แก่ ชิ้นงาน A-F ประกอบไปด้วยชิ้นงานที่มี ชั้น GaAs Spacer หนา 50, 100, 250 nm (ชิ้นงาน A-C) และชิ้นงานที่ใช้วิธีการปลูกควอนตัมดอตแบบ MEE ซึ่งใช้ปริมาณสารในการปลูกไม่เท่ากัน (ชิ้นงาน D และ E) และชิ้นงานสำหรับวัดทางแสงโดย เทคนิค PL ได้แก่ ชิ้นงาน G

ตารางที่ 4.1 ชิ้นงานทั้งหมดที่ได้จากการทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ชิ้นงานสำหรับศึกษากายภาพ

Sample	GaAs Capping	InAs	GaAs	In _{0.15} Ga _{0.85} As	GaAs Buffer
	Layer	QD	Spacer	layer	Layer
	Thickness	(ML)	Thickness	Thickness	thickness
	(nm)		(nm)	(nm)	(nm)
А	- 🧶	1.8 SK	50	50	300
В	dial	1.8 SK	100	50	300
С	านย	1.8 SK	250	50	300
D	- u	- 6	250	50	300
E	หาลงก	1.8 MEE	250	50	300
Fġ	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1.8	250	50	300
		Overgrowth			
		50% MEE			
G	100	1.8 SK	250	50	300

ของผ<mark>ิวหน้าแล</mark>ะชิ้นง<mark>านสำห</mark>รับวัด<mark>ทางแสงใด</mark>ยเทคนิค PL

4.2 ผิวหน้าของชั้น GaAs spacer และการจัดเรียงควอนตัมดอตบนผิวหน้า

ผลของการเพิ่มขั้น GaAs spacer ที่มีความหนาแตกต่างกันจะถูกศึกษาในหัวข้อนี้ โดยจะศึกษา ลักษณะกายภาพของผิวหน้าเป็นหลัก พร้อมกับแสดงการเรียงตัวของควอนตัมดอตที่เกิดขึ้น

4.2.1 ผิวหน้าของชั้น GaAs spacer

เมื่อเพิ่มชั้น GaAs spacer ลงบนผิวหน้าทำให้ลักษณะของผิวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ผิวหน้าของแผ่นฐานเสมือนลายตารางเดิม ดังภาพ AFM ในรูปที่ 4.2 ผิวหน้าของชิ้นงานที่มีชั้น GaAs spacer มีแนวของเนินในทิศทาง [110] ขนาดใหญ่กว่า จาก line scan ในรูปที่ 4.2 ข) ซึ่งเป็นภาพ AFM ที่ได้จากชิ้นงาน D พบว่ามีความกว้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,336 nm เมื่อเปรียบเทียบกับผิวหน้าของลาย ตาราง In_{0.15}Ga_{0.85}As ที่ปราศจากชั้น GaAs spacer ในรูปที่ 4.2 ก) ของ C.C. Thet [33] ซึ่งมีความกว้าง เฉลี่ย 455 nm เท่านั้น ในส่วนความลึกของแนวเนินจากยอดถึงพื้น (peak to valley) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.19 nm ในรูปที่ 4.2 ก) เป็น 4.48 nmในรูปที่ 4.2 ข) นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นค่าความสูงที่เพิ่มขึ้นจาก ปกติในปริเวณที่แนวของเนินทั้งสองทิศทางตัดกันดังแสดงในรูปที่ 4.2 ค) ในส่วนความกว้างแนวเนินและ ความลึกจากยอดลึกพื้นในทิศทาง [1-10] มีค่าเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับใน ทิศทาง [110] ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของผิวหน้าทั้งสองถูกสรุปและแสดงในตารางที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ภาพ AFM ขนาด 10x10 µm² แสดงลักษณะผิวหน้าที่ยังไม่ได้ปลูกควอนตัมดอต ก) โครงสร้าง 50 nm In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs [33] และ ข) ชิ้นงาน D ซึ่งมีโครงสร้าง 250 nm GaAs Spacer/ 50 nm In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs และ ค) line scan ของชิ้นงาน D ตามตำแหน่งในรูป b)

Structure	Peak to valley	/ Height (nm)	Ridge Width (nm)		
	[110]	[1-10]	[110]	[1-10]	
50nm	1.42	2.67	455	623	
In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs					
Sample D	1.19	4.48	1,336	713	

ตารางที่ 4.2 ความกว้างของเนินและความลึกจากยอดถึงพื้นในทิศ [110] และ [1-10] ของโครงสร้าง In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs และชิ้นงาน D

การเปลี่ยนแปลงของผ<mark>ิวหน้าสามา</mark>รถอธิบา<mark>ยได้ดังรูปที่</mark> 4.3 ผิวหน้าของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละขั้นตอนการปลูก ผิว<mark>หน้าลายตารางของชิ้นงานที่ไม่มีชั้น</mark> GaAs spacer ในรูปที่ 4.3 ก) มี ้ลักษณะเป็นแนวของเนิน (Ridge) เล็ก ๆ ที่เรียงตัวตลอดทั่วทั้งชิ้นงานในสองทิศทาง [110] และ [1-10] ซึ่งเกิดจาก misfit dislocation ข<mark>องการคลายความเครียดเพียงบา</mark>งส่วนของชั้น InGaAs ในระบบ In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs เมื่อเกินจากความหนาวิกฤติ ซึ่งในที่นี้มีค่าความหนาวิกฤติประมาณ 10 nm ้สำหรับ In 15% ตามแบบจ<mark>ำลองของ Matthews and Blakeslee ต่</mark>อมาเมื่อปลูกชั้น GaAs spacer ลง บนผิวชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ <mark>4.3 ข</mark>) แนวข<mark>อง dislocat</mark>ion ที่<mark>มีอยู่เด</mark>ิมก่อให้เกิดแนวของ dislocation ใหม่ แต่แนวของ dislocation ใหม่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปบนผิวหน้าได้หมดโดยเฉพาะเมื่อชั้น GaAs spacer มี ้ความหนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบางส่ว<mark>นหยดอย่ในเนื้อชิ้นงานหรือเบี่ยงเบนออกไปนอกชิ้นงานดังที่อธิบาย</mark> ในบทที่ 2 (หัวข้อ 2.3.3.2.3) ผลที่ได้จึงปรากฦเป็น surface step ขึ้นบนผิวหน้าคล้ายในกรณีของลาย ิตารางของ In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs หลังจากนั้นจึงเกิดกระบวนการของ surface step elimination ผลที่ได้ จึงเกิดเป็นแนวเนินยาวตลอดทั้งชิ้นงาน (รูปที่ 4.3 ค)) ในสองทิศทางเช่นกันแต่มีรูปร่างที่เปลี่ยนไป จาก ค่า peak to valley หรือค่าความลึกของแนวเนินจากยอดเนินถึงพื้นด้านล่างและค่า ridge width คือค่า ความกว้างของแนวเนินซึ่งวัดในทิศทาง [110] และ [1-10] จะเห็นได้ว่าแนวของเนินโดยเฉพาะในทิศทาง [110] เป็นแนวเนินที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเป็นผลจากแนวของ dislocation ใหม่ที่ชิดกันมาก [58] ้นอกจากนี้เมื่อพิจารณา line scan ในรูปที่ 4.2 ค) .แสดงให้เห็นถึงแนวของเนินในทิศ [1-10] มีความลึก และความเป็นลอนมากกว่าเมื่อเทียบกับทิศ [110] ลักษณะผิวหน้าดังกล่าวที่แตกต่างไปจากเดิมจะส่งผล ให้การก่อตัวของควอนตัมดอตที่ได้แตกต่างไปจากเดิมเมื่อทำการปลูกควอนตัมดอต ผลของการปลูก ควอนตัมดอตลงไปบนผิวของชิ้นงานที่มีชั้น GaAs spacer จะถกศึกษาและอธิบายพร้อม ๆ กลไกการ ขยายตัวของแนวเนินในหัวข้อถัดไป



รูปที่ 4.3 ลำดับของการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าในการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการก่อตัวควอนตัมดอตใหม่ โดยแสดงกลไกพร้อมลักษณะการก่อตัวของผิวหน้าของชิ้นงาน ก) การเกิดลายตารางขึ้นจากการเลื่อน ของระนาบผลึกเนื่องจาก misfit และ threading dislocation ของชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ข) การเพิ่ม ชั้น GaAs spacer ทำให้แนวของ dislocation เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบางส่วนหยุดหรือเบี่ยงเบนไปจาก ทิศทางเดิม ในขณะที่มีบางส่วนผ่านขึ้นยังผิวหน้าได้ และ ค) แสดงการเกิดของแนวเนินขนาดต่างๆ ซึ่ง

เป็นผลจากการเลื่อนของระนาบบนผิวหน้าและการเกิด surface step elimination

4.2.2 ควอนตัมดอตบนผิวหน้าของชั้น GaAs spacer

n) การจัดเรียงตัวควอนดัมดอตบนผิวหน้าของ GaAs spacer

การเรียงตัวของ InAs ควอนตัมดอตบน GaAs โดยทั่วไปเป็นอย่างไม่มีระเบียบเนื่องจากการ เกิดขึ้นแบบสุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ก) ซึ่งได้จากการปลูก 1.8 ML InAs ควอนตัมดอตบนชั้น GaAs โดยตรง ของ S. Kiravittaya [79] การเรียงตัวของควอนตัมดอตจะเป็นระเบียบมากขึ้นเมื่ออาศัยชั้นลาย ตาราง InGaAs/GaAs ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ข) เป็นรูปที่ได้จากการปลูก 1.8 ML InAs ควอนตัมดอตบน ชั้น 50 nm In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ของ C.C. Thet [33] สำหรับการปลูก InAs ควอนตัมดอตบนชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ที่มีชั้น GaAs Spacer จะให้ผลที่แตกต่างออกไปดังแสดงในรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 ภาพ AFM ของการปลูก 1.8 ML InAs QDs บน ก) In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs

<mark>ข</mark>) GaAs (1<mark>00) ซับสเตรตพร้อมควา</mark>มสูง [77,79]

การเปลี่ยนแปลงความหนาของชั้น GaAs spacer มีผลต่อการเรียงตัวของควอนตัมดอตตาม ลักษณะผิวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป รูปที่ 4.5 แสดงลักษณะการจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตของ ก) โครงสร้าง 50 nm In_{0.15}Ga_{0.65}As/GaAs, ข) ชิ้นงาน A, ค) ชิ้นงาน B และ ง) ชิ้นงาน C โดยพบว่าการ จัดการเรียงตัวของควอนตัมดอตปรากฏทั่วไปในสองทิศทาง คือ ทิศ [110] และทิศ [1-10] เมื่อไม่มีชั้น GaAs Spacer (รูป 4.5 ก)) แต่เมื่อชั้น GaAs spacer หนาขึ้น ความหนาแน่นของเส้นการเรียงตัวของ ควอนตัมดอตมีค่าน้อยลงในทั้งสองทิศทาง โดยเฉพาะในทิศ [1-10] มีค่าลดลงอย่างมาก ทำให้การ จัดเรียงตัวในทิศทาง [110] มีความโดดเด่นมากกว่า ดังแสดงในรูป 4.5 (ข, ค และ ง) พร้อมกันนี้ยัง ปรากฏให้เห็นแนวของเนินขนาดใหญ่บริเวณผิวหน้าของชิ้นงานทั้งสองทิศทาง ความกว้างของแนวเนิน เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อความหนาของชั้น GaAs spacer โดยเฉพาะในทิศทาง [110] แนวเนินเหล่านี้คือ surface step ที่เกิดจากการเลื่อนตัวของระนาบผลึก โดยมีจุดกำเนิดจาก misfit dislocation ที่เกิดจาก การคลายตัวบางส่วนของความเครียดเนื่องจากความไม่เข้ากันของโครงร่างผลึก InGaAs กับ GaAs (ประมาณ 1%) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเกิดลายตารางในระบบ InGaAs/GaAs [54] แต่ลักษณะของ dislocation จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเมื่อปลูกขั้นของ GaAs spacer ลงไปบนชั้นของเนินเหล่านี้จะ ทำให้พลังงานพื้นผิวลดลง surface step ที่มีอยู่ถูกทำลายลง [55] ส่งผลให้เกิดแนวของเนินที่มีความ กว้างขึ้นในทิศทาง [1-10] และทิศทาง [110] บนชั้นของ GaAs spacer กรก่อตัวของควอนตัมดอตจะ เกิดขึ้นบริเวณขอบของแนวเนินเหล่านี้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีพลังงานต่ำ จึงเป็น preferential site สำหรับการก่อตัว [78]



ร**ูปที่ 4.5** ภาพ AFM ขนาด 10x10 µm² แสดงลักษณะการก่อตัวของ InAs ควอนตัมดอตที่ปลูกด้วย วิธีแบบ SK ของ ก) ชิ้นงาน In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ข) ชิ้นงาน A ค) ชิ้นงาน B และ ง) ชิ้นงาน C ตามลำดับโดยในแต่ละรูปทางด้านมุมขวาบนมีรูปขยายขนาด 0.5x0.5 µm² ในบริเวณตำแหน่งที่ สนใจและลูกศรสีขาวแสดงทิศทาง [1-10]

ข) ลักษณะทางกายภาพของควอนตัมดอตบนผิวหน้าของชั้น GaAs spacer

ค่าความสูง ขนาด และความหนาแน่นของควอนตัมดอต รวมถึงค่าความกว้างของแนวเนิน ใน แต่ละชิ้นงาน ถูกแสดงในตารางที่ 4.3 ความสูงและขนาดของควอนตัมดอตในชิ้นงานมีค่าสูงขึ้นเมื่อ ความหนาของชั้น GaAs spacer เพิ่มขึ้น แต่เปลี่ยนแปลงไม่มากนักในชิ้นงาน A และ B ที่มีความหนา 50 และ 100 ตามลำดับ ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกับการปลูกควอนตัมดอตบนชั้นเสมือนลายตารางโดยตรง ของ C.C. Thet [33] ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ข) ซึ่งมีค่าความสูงโดยเฉลี่ย 5 nm แต่มีขนาดใหญ่กว่า โดยเฉพาะในทิศ [110] เมื่อความหนาของชั้น GaAs เพิ่มเป็น 250 nmในชิ้นงาน C ค่าความสูงจะ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้น (6.17 nm) และมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในทิศ [110] ขนาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่สมมาตรในทิศ [110] และทิศ [1-10] เป็นผลจากความแตกต่างของลวดลาย แนวเนินที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าเนื่องจากความไม่เท่ากันของ dislocation ในสองทิศทาง [56] ซึ่งเปรียบเทียบ กับขนาดของ InAs ควอนตัมดอตที่ปลูกบนชั้น GaAs โดยตรงของ S. Kiravittaya [79] ที่ปลูกด้วย เงื่อนไขเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ก) พบว่ามีความสูงเป็น 10.7 nm แต่มีขนาดที่เล็กกว่า (38 nm) ลักษณะดังกล่าวเมื่อแสดงให้เห็นถึงความหนาที่เพิ่มขึ้นทำให้ระบบโดยรวมเปลี่ยนจากการปลูก InAs/In_{0.15}Ga_{0.85}As ไปเป็น InAs/GaAs แต่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเนื่องจากยังมีผลของ dislocation ที่ยังคง ส่งผลต่อลักษณะผิวหน้าของชิ้นงาน ในส่วนความหนาแน่นของควอนตัมดอตมีความหนาแน่นต่างกัน น้อยในชิ้นงาน A และ B แต่ลดลงอย่างมากในชิ้นงาน C เนื่องจากควอนตัมดอตมีการจัดเรียงตัวและ เลือกก่อตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับควอนตัมดอตที่เกิดบนชั้น GaAs โดยตรงและบนชั้นลาย ตาราง In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs พบว่ามีความหนาแน่นที่น้อยกว่าในทุกชิ้นงานที่มีชั้น GaAs spacer

ตารางที่ 4.3 ค่าความสูง ความหนาแน่นของควอนตัมดอต และขนาดของแนวเนิน ที่เกิดขึ้นในชิ้นงานที่ ปลูก InAs ควอนตัมดอตแบบ SK บนชิ้นงาน A, B และ C ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของ ชิ้นงานที่ปลูก InAs ควอนตัมดอตแบบเดียวกันบนผิวหน้าของ GaAs โดยตรงของ S.Kiravittaya [79] และบน In_{0 15}Ga₀₈₅/GaAs ของ C C Thet [80]

Structure	GaAs	Dot	Dot	Dot Size (nm)		Ridge Width (nm)	
	Spacer	Density	Height				
	Thickness	(cm ⁻²)	(nm)	[110]	[1-10]	[110]	[1-10]
	(nm)	~20207					
Sample A	50	1.03x10 ⁹	4.57	118.57	103.22	467.75	190.23
Sample B	100	1.08x10 ⁹	4.75	120.57	114.33	730.87	713
Sample C	250	9.39x10 ⁸	6.36	169.70	129.07	1387.5	1256
In _{0.15} Ga _{0.85} As/GaAs	ปยาว	6.1x10 ⁹	5	75	93	-	-
InAs/GaAs	N 1 0	6x10 ⁹	10.7	38	3*	-	-

*average diameter

ค) การจัดเรียงควอนตัมดอตแบบ SK ในรูปแบบ MEE

วิธีการปลูกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตบนพื้นผิวของซิ้นงานที่ มีชั้น GaAs spacer ในการทดลองจะใช้วิธีการปลูกอยู่ 2 วิธีคือการปลูกแบบ SK ปกติ และการปลูกแบบ SK Migration Enhance Epitaxy (MEE) ความแตกต่างของวิธีการปลูกทั้งสอง คือลักษณะการเปิดชัต เตอร์ของสารในขณะปลูกควอนตัมดอต ในการปลูกควอนตัมดอตสารที่ใช้คือ In และ As สำหรับวิธีการ ปลูกแบบปกติ ชัตเตอร์ In และ As จะเปิดตลอดเวลาขณะทำการปลูกควอนตัมดอต ในขณะที่การปลูก แบบ MEE ชัตเตอร์ของ In และ As จะเปิดปิดสลับกัน ดังได้กล่าวบทที่ 3 (รูปที่ 3.17)



รูปที่ 4.6 ลักษณะการเปิดปิดชัตเตอร์ In และ As ในชิ้นงาน E และ F

ผลการทดลอง แนวของการก่อตัวและการเรียงตัวของควอนตัมดอตในการปลูกแบบ SK ปกติที่ จะเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในทิศทาง [110] (รูปที่ 4.5 ง)) ในขณะที่การปลูกด้วยวิธีแบบ MEE การเรียงตัว ของควอนตัมดอตจะโดดเด่นในทิศทาง [1-10] ดังแสดงในรูปที่ 4.7 ก) และ 4.7 ข) ซึ่งเป็นภาพ AFM ที่ได้ จากชิ้นงาน E และ ชิ้นงาน F ตามลำดับ ทั้งสองชิ้นงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกัน มีวิธีการปลูก ควอนตัมดอตแบบเดียวกัน คือ แบบ MEE แต่แตกต่างในจำนวนวัฏจักรการเปิดและปิดชัตเตอร์สาร In และ As ซึ่งชิ้นงาน E มีจำนวนวัฏจักรที่มากกว่าชิ้นงาน F อยู่ 50% ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.7 ภาพ AFM ขนาด 10x10 µm² ของชิ้นงาน F และ G ซึ่งปลูกควอนตัมดอตแบบ MEE โดย over growth ก) 0% และ ข) 50% ตามลำดับ โดยในแต่ละรูปทางด้านมุมขวาบนมีรูปขยายขนาด 0.5x0.5 µm² ในบริเวณที่สนใจ และลูกศรสีขาวแสดงถึงทิศทาง [1-10] การเปลี่ยนแปลงทิศการเรียงตัวของควอนตัมดอตเมื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกเป็นผลมาจาก ลักษณะของความแตกต่างของแนวเนินในสองทิศทาง ลักษณะของควอนตัมดอตยังคงก่อตัวบริเวณขอบ ของเนินที่เกิดขึ้น แต่เป็นแนวของเนินในทิศทางที่ไม่เหมือนกัน เมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของ แนวเนินทั้งสองทิศทางพบว่ามีความแตกต่างกัน ดังรูปที่ 4.2 ค) line scan ของลักษณะพื้นผิวใน สองทิศทาง พบว่าแนวของเนินในทิศทาง [1-10] มีความลึกและความเป็นรอนคลื่นมากกว่าเมื่อเทียบกับ แนว [110] ทำให้เกิดความไม่เท่ากันขึ้นในการก่อตัวทั้งสองทิศทาง ซึ่งโดยมากอะตอมของ In ชื่นชอบที่ จะเคลื่อนที่ไปในทิศทาง [1-10] มากกว่า [81] นอกจากนี้ผลของระนาบผลึกที่เปลี่ยนไปเนื่องจากพื้นผิวที่ เป็นรอนคลื่นยังมีส่วนสำคัญต่อการเลือกก่อตัวของควอนตัมดอตบนพื้นผิวเช่นด้วยกัน

ความแตกต่างของพื้นผิวที่เกิดขึ้นรวมกับการเคลื่อนที่ของพาหะที่ไม่เหมือนกันเนื่องการเปิด-ปิดชัตเตอร์ที่แตกต่างกันของการปลูกทั้งสองวิธี ก่อให้เกิดการสลับทิศการเรียงตัวโดดเด่นของควอนตัม ดอตขึ้น ในการปลูกควอนตัมดอตแบบปกติ In adatoms มีอิสระและความยาวแพร่ (diffusion length) สั้น เนื่องจากการเคลื่อนที่ของอะตอม In บนพื้นผิวจะถูกรบกวนโดยไอของลำโมเลกุลของ As₄ ตลอดเวลา จึงไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะเอาชนะพลังงานความเครียด (strain energy) ที่เกิดจาก surface step ในทิศทาง [1-10] ได้ และการก่อตัวขึ้นบริเวณขอบของเนินในทิศทาง [110] แทนเนื่องจาก ใช้พลังงานน้อยกว่า แต่สำหรับการปลูกแบบ MEE อะตอม In จะถูกรบกวนโดยไอของลำโมเลกุล As₄ ลดลง ทำให้ In adatoms มีอิสระ รวมถึงมีพลังงานในการเคลื่อนที่มากกว่า ทำให้เคลื่อนที่ได้ไกลกว่า [81] การก่อตัวของควอนตัมดอตจึงเกิดขึ้นในบริเวณขอบของแนวเนินในทิศทาง [1-10] เนื่องจากเป็น บริเวณที่มีพลังงานที่น้อยที่สุด [78]

4.3 สมบัติทางแสงของชิ้นงาน

หัวข้อที่ผ่านมาได้อธิบายลักษณะทางกายภาพของควอนตัมดอตที่เกิดบน GaAs spacer เฉพาะผิวหน้าเท่านั้น การศึกษาสมบัติโดยรวมของชิ้นงานจำเป็นต้องรวมสมบัติทางแสงเข้าไว้ด้วย คุณภาพการเปล่งแสงที่ดีบ่งบอกถึงชิ้นงานที่สามารถนำไปผลิตเป็นอุปกรณ์อ็อปโตอิเล็กทรอนิกส์ในเชิง พาณิชย์ได้ ค่ายอดพลังงานของแสงที่เปล่งออกมาทำให้ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีของสารต่าง ๆ ที่มี อยู่ในชิ้นงาน

สมบัติทางแสงของชิ้นงานได้ถูกวัดโดยเทคนิค PL ภายใต้เงื่อนไขการทดลอง 3 เงื่อนไข คือ

n) การวัดสเปกตรัมของแสงที่เปล่งออกมาในสภาวะที่อุณหภูมิของชิ้นงานมีค่าคงที่แต่ความเข้ม ของแสงเลเซอร์กระตุ้นเปลี่ยนแปลงไป

- การวัดสเปกตรัมของแสงที่เปล่งออกมาในสภาวะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปแต่ความเข้มของ แสงเลเซอร์กระตุ้นมีค่าคงที่
- ค) การวัดค่าความเข้มแสงเมื่อผ่าน Polarizer ที่มุมต่างๆ ในสภาวะที่อุณหภูมิและกำลังแสงเลเซอร์ กระตุ้นคงที่

หัวข้อนี้จะอธิบายลักษณะทั่วไปของการเปล่งแสงของชิ้นงาน G ตามด้วยผลการทดลองทั้งสาม ข้างต้น ตามลำดับดังนี้

4.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของการเปล่งแสงของชิ้นงาน

ลักษณะการเปล่งแสงโดยทั่วไปของขึ้นงาน G ประกอบด้วยยอดพลังงาน (peak) หลัก 4 ยอด อยู่ในช่วง 1.0-1.5 eV ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มพลังงานต่ำ (I และ II) และกลุ่ม พลังงานสูง (III และ IV) ดังรูปที่ 4.8 กลุ่มพลังงานต่ำคือ ยอดพลังงานที่ I และ II (1.076 eV และ 1.12 eV ตามลำดับ) เกิดจากการเปล่งแสงของควอนตัมดอต โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองของ InAs ควอนตัมดอตบน GaAs ของ Kiravittaya [79] และ Rudeeson [82] พบว่าสำหรับ 1.8 ML InAs ควอนตัมดอตที่ปลูกด้วยอัตราการปลูก 0.01 ML/s ค่ายอดพลังงานปรากฏในค่า 1.05 eV ซึ่งใกล้เคียง กับยอดพลังงานที่ I มากกว่าค่ายอดพลังงานที่วัดได้จากการปลูกควอนตัมดอตแบบเดียวกันบนชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ที่ไม่มีชั้น GaAs Spacer ซึ่งจะปรากฏในค่ายอดพลังงานที่ 1.19 eV [33]



รูปที่ 4.8 สเปกตรัมการเปล่งแสงโดยทั่วไปของชิ้นงาน G โดยระบุตำแหน่งของยอดพลังงานหลักที่ เกิดขึ้น 4 ค่า ด้วย สัญลักษณ์ I , II , III และ IV ตามลำดับ

ในส่วนยอดพลังงานที่ II ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับค่ายอดพลังงานที่ I จากการทดลองโดยการ เปลี่ยนแปลงกำลังแสงเลเซอร์กระตุ้นซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป ทำให้ทราบว่าเกิดจากกลุ่มควอนตัม ดอตอีกขนาดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากควอนตัมดอตของยอดพลังงานที่ I โดยยิ่งควอนตัมดอตมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ช่องว่างแถบพลังงานของพาหะในควอนตัมดอตมีค่ามากขึ้น ดังได้กล่าวถึงในบทที่ 2 เกี่ยวกับ ขนาดและผลของช่องว่างแถบพลังงานที่เปลี่ยนไปในโครงสร้างขนาดเล็ก สังเกตได้จากกราฟการกระจาย ตัวความสูงและความกว้างของควอนตัมดอตของชิ้นงานขณะที่ยังไม่ได้กลบทับหรือชิ้นงาน C รูปที่ 4.9 n), ข) และ ค) จะเห็นได้ว่ามีความสูงและขนา<mark>ดที่</mark>แตกต่างกัน แต่เมื่อเปล่งแสงรวมกันแล้วปรากฦให้เห็น ้เป็นยอดพลังงานที่โดดเด่นบางค่าขึ้<mark>นอย่กับปริมาณและค</mark>วามหนาแน่นของควอนตัมดอตที่เปล่งแสง ในช่วงนั้น ยอดพลังงานที่ I แล<mark>ะ II จึงเป็นลักษณะของการเปล่งแ</mark>สงแบบ Bimodal ที่พบได้ในการทดลอง เกี่ยวกับ InAs ควอนตัมดอต บน GaAs ซึ่งใช้ InAs coverage ที่ไม่เท่ากันของ S.J. LEE [83] ดังแสดง ในรูปที่ 4.9 ซึ่งเป็นผลการ<mark>เปล่งแสงของควอนตัมดอตคนละขนาด 2</mark> กลุ่ม เมื่อพิจารณาความสูงพบว่า ้ควอนตัมดอตกลุ่มแรก (เส้นประด้านซ้ายในรูปที่ 4.9 ก) เป็นควอนตัมดอตที่มีความสูงเฉลี่ยที่ 5 nm และ ึกลุ่มที่ 2 เป็นควอนตัมด<mark>อ</mark>ตที่มีความสูงเฉลี่ย 6.5 nm ความสูงของควอนตัมดอตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ้ควอนตัมดอตเปล่งแสงในค<mark>วามยาวคลื่</mark>นที่ม<mark>ากขึ้น [84] ควอนตัมดอ</mark>ตในกลุ่มที่ 1 จึงเป็นควอนตัมดอตที่ เปล่งแสงในยอดพลังงานที่ II <mark>และก</mark>ารเป<mark>ล่งแสงในยอ</mark>ดพลังงานที่ I จึงเป็นของควอนตัมดอตในกลุ่มที่ 2 ตามลำดับ ดังนั้นความเข้มของการเ<mark>ปล่งแสงในยอดพลัง</mark>งานที่ I จึงมีค่ามากกว่าในยอดพลังงานที่ 2 เนื่องจากปริมาณควอนตัมดอตในกลุ่มแรกมีน้อยกว่าในกลุ่มที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง เมื่อ พิจารณาความกว้างเฉลี่ยของควอนตัมดอตในทิศ [110] และ [1-10] ดังรูปที่ 4.10 ข) และ 4.10 ค) ตามลำดับ พบว่ามีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในช่วง 145-195 nm ในทิศ [110] และในช่วง 110-130 nm ในทิศ [1-10] รูปร่างควอนตัมดอตจึงยาวออกในทิศ [110] มากกว่าในทิศ [1-10] ความกว้างที่ไม่ เท่ากันของควอนตัมดอตมีผลต่อการเปล่งแสงเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องสถานะกระตุ้นแต่มีผลน้อยกว่า ต่อสถานะพื้นเมื่อเทียบกับความสูง [84]



รูปที่ 4.9 กราฟแสดงผลของการเปล่งในการทดลองของ S.J.LEE [83]



รูปที่ 4.10 กราฟแสดงการกระจายตัว ก) ความสูงของควอนตัมดอตและความกว้างในทิศทาง ข) [1-10] และ ค) [110] ของชิ้นงาน C

นอกจากนี้ยอดพลังงานที่ II ยังประกอบไปด้วยแสงจากสถานะกระตุ้นของยอดพลังงานที่ I ซึ่งมี แสดงให้เห็นเช่นกันในรายงานของ S.J. LEE โดยจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อผลของกำลังเลเซอร์กระตุ้นต่อ การเปล่งแสง

ในส่วนของค่าพลังงานด้านสูงอีกสองค่า คือ 1.31 eV และ 1.41 eV ของยอดพลังงานที่ III และ ยอดพลังงานที่ IV ตามลำดับ ยอดพลังงานที่ III เป็นค่ายอดพลังงานที่เกิดจากชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As ภายใน โครงสร้าง ซึ่งมีรายงานแสดงให้เห็นถึงยอดพลังงานดังกล่าวในการทดลองเกี่ยวกับทางแสงของโครงสร้าง InAsควอนตัมดอตบนชั้น 50 -100 nm In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ของ Chit Swe, N.T [85] ซึ่งพบยอด พลังงานดังกล่าวในช่วง 1.29-1.32 eV

ส่วนยอดพลังงานที่ IV เป็นยอดพลังงานที่เกิดจากการเปล่งแสงของชั้น Wetting layer ของ InGaAs ซึ่งเกิดขึ้นขณะปลูกควอนตัมดอต โดยค่ายอดดังกล่าวมีรายงานแสดงให้เห็นอย่างอย่าง แพร่หลายในเรื่องการปลูก InAs ควอนตัมดอตที่ความหนาต่ำกว่าค่าความหนาวิกฤติ (1.7 ML) [86] บน พื้นผิวเรียบของ GaAs เช่น ปรากฏในการปลูก InAs ควอนตัมดอตที่ความหนา 1.15-1.35 ML ของ Heitz [87] และการปลูก InAs ควอนตัมดอตหนา 1.2-1.35 ML ของ Duarte [88]

4.3.2 ผลของกำลังเลเซอร์กระตุ้นต่อการเปล่งแสง

การเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสงเลเซอร์กระตุ้นช่วยให้สามารถวิเคราะห์และจำแนกชนิดของ ยอดพลังงานที่เกิดขึ้นได้ว่าเกิดจากสถานะพื้น (ground state) หรือเกิดจากสถานะกระตุ้น (excited state) ในการทดลองได้ทำการเปลี่ยนแปลงกำลังแสงเลเซอร์ 5 ค่า คือ 2, 5, 10,15 และ 20 mW ผลของ การทดลองดังปรากฏในรูปที่ 4.11 ลักษณะของการเปล่งแสงของขึ้นงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือมี 4 ยอดพลังงานและมีความเข้มที่สูงขึ้นตามค่ากำลังแสงเลเซอร์สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงกำลังแสงเลเซอร์ มีผลโดยตรงกับความเข้มการเปล่งแสงของชิ้นงาน ซึ่งเป็นผลจาก state-filling effect [82] ที่ทำให้เกิด การเพิ่มจำนวนของพาหะที่มีพลังงานสูงมากพอในแต่ระดับชั้นพลังงานเนื่องจากได้พลังงานกระตุ้นจาก แสงเลเซอร์ ความแตกต่างจะเริ่มมีความชัดเจนในกรณีกำลังเลเซอร์กระตุ้นต่ำที่ 2 mW และกำลังเลเซอร์ กระตุ้นสูงที่ 20 mW

เมื่อค่ากำลังเพิ่มถึง 20 mW เริ่มปรากฏให้เห็นยอดพลังงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ระหว่าง II และ III (รูป ที่ 4.12) แต่ในกรณีกำลังเลเซอร์กระตุ้นต่ำที่ 2 mW ปรากฏให้เห็นชัดเจนเฉพาะ I และ II เท่านั้น ในส่วน ยอดพลังงานที่ III และ IV คาดว่ายังคงมีอยู่แต่ไม่สามารถตรวจจับได้เนื่องจากมีความเข้มน้อยมากจนไม่ สามารถแยกความแตกต่างออกจากสัญญาณรบกวน (noise) ของการวัดได้ เมื่อเปรียบเทียบกันจึงยืนยัน ถึงยอดพลังงานพื้นทั้งสี่ของชิ้นงานได้ ยอดพลังงานที่เพิ่มขึ้นระหว่างยอดพลังงานที่ II และ III เป็นค่า ยอดจากสถานะกระตุ้นของกลุ่มควอนตัมดอตในยอดพลังานที่ II ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ไปยังระดับชั้น พลังงานถัดไปของอิเล็กตรอนเนื่องจากมีพลังงานสูงมากพอจากแสงเลเซอร์กระตุ้น



รูปที่ 4.11 สเปกตรัมการเปล่งแสงของชิ้นงาน G เมื่อเปลี่ยนแปลงกำลังเลเซอร์ที่ใช้ในการกระตุ้นที่กำลัง แสงเลเซอร์กระตุ้นที่อุณหภูมิ 20 K





4.3.3 ผลของอุณหภูมิต่อการเปล่งแสง

การเปล่งแสงของชิ้นงานเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิแสดงในรูปที่ 4.13 เมื่อพิจารณาความเข้ม แสงดังแสดงในรูปที่ 4.14 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงในแต่ละยอดพลังงานกับอุณหภูมิ จากผลการทดลองพบว่าในช่วงแรกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วง 20-90 K ความเข้มของการเปล่งแสงในแต่ ละยอดพลังงานมีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเพิ่มสูงสุดที่ 90 K จากนั้นจึงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 100-200K ความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกเป็นผลจากการเพิ่มของจำนวนอิเล็กตรอนที่ได้รับ พลังงานมากขึ้นจนถึงระดับพลังงานนั้นๆ อันเป็นผลจากการกระตุ้นด้วยความร้อน Thermal excitation [88] จากนั้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 100 K จนถึง 200 K ความเข้มแสงที่ลดลงเนื่องจากการหลุด ออกไปของพาหะหรืออิเล็กตรอนจากควอนตัมดอต เนื่องจากการกระตุ้นด้วยความร้อนที่มีสูง โดยการ เปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดเจนในยอดพลังงานที่ I และยอดพลังงานที่ II

ตำแหน่งของยอดพลังงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิดังแสดงในรูปที่ 4.15 ในช่วงอุณหภูมิ 20-90 K ปรากฏการเลื่อนตำแหน่งของยอดพลังงานไปยังพลังงานสูงขึ้น (blue shift) จากนั้นเมื่ออุณภูมิสูงขึ้นอีกจนถึง 200 K ปรากฏการเลื่อนของยอดพลังงานไปยังพลังงานต่ำหรือ "red shift" การเลื่อนของยอดพลังงานในแต่ละช่วงสามารถอธิบายได้ดังนี้ ในช่วงแรกอุณหภูมิ 20-90 K ตำแหน่งของยอดพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจาก band filling effect เนื่องจากมีพาหะได้รับพลังงานสูงขึ้น จากพลังงานความร้อน [89] ซึ่งสอดคล้องกับค่าความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ ผลของ Band filling effect ทำให้เกิดการเลื่อนของยอดพลังงานไปยังพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งพบได้ในทั้งควอนตัมดอตและลวด



ิ พูนยวทยทวพยากว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการทดลอง ค่า *E*_o ที่ได้คือ 1.1 eV ซึ่งมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับการทดลองสำหรับยอดพลังงานที่ I สำหรับยอดพลังงานที่ II การปรับค่าดังกล่าวไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปตามสมการของ Varshni ถึงแม้จะ ปรับค่า *E*_o เพื่อปรับค่าแล้วก็ตาม ผลดังกล่าวคาดว่าจะเป็นผลจาก excited state ของ ยอดพลังงานที่ I ซึ่งรวมอยู่ในยอดพลังงานที่ II ความสัมพันธ์ของค่ายอดพลังงานที่เปลี่ยนไปของยอดพลังงานที่ I และ II จากการทดลองเทียบกับสมการของ Varshni แสดงในรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.14 ค่าความความเข้มแสงที่เป<mark>ล่งออกจากค่ายอดพ</mark>ลังงานต่าง ๆ ของชิ้นงาน G เมื่อเปลี่ยนแปลง



รูปที่ 4.15 ตำแหน่งของค่ายอดพลังงานของชิ้นงาน G ที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ


รูปที่ 4.16 เปรียบเทียบค่ายอดพลังงานที่เปลี่ยนไปของยอดพลังงานที่ I และ II กับค่าที่ได้ จากสมการ Varshni พร้อมกับเส้นประที่ได้จากการปรับค่า *E*_o ในสมการ Varshni

4.3.4 <mark>ผลของโพลาไรเซชั่น</mark>

ในการศึกษาสมบัติโพลาไรเซชั่นของแสงที่เปล่งออกจากชิ้นงานได้ใช้แผ่นโพลาไซส์วางอยู่ ข้างหน้าแสงของชิ้นงานก่อนที่จะผ่านโมโนโครมิเตอร์ โดยก่อนที่จะทำการวัดต้องทำการปรับหามุมที่ให้ ค่าความเข้มของแสงมากที่สุด จากนั้นจึงตั้งค่ามุมดังกล่าวให้เป็นมุมอ้างอิง (0 องศา) หลังจากนั้นจึงทำ การปรับมุมของแผ่นโพลาไรเซอร์ไปยังค่าต่าง ๆ ตามต้องการ การวัดกระทำที่อุณหภูมิ 20 K ด้วยกำลัง เลเซอร์กระตุ้น 40 mW

ผลการทดลองในรูปที่ 4.17 แสดงว่า ยอดพลังงานที่ I และ II เท่านั้นที่มีสมบัติโพลาไรเซชั่น บ่ง บอกถึงแสงมาจากแหล่งกำเนิดที่มีทิศทางการเรียงตัวที่แน่นอน ซึ่งในที่นี้คือควอนตัมดอต ดังปรากฏใน รูป AFM ของผิวหน้า (รูปที่ 4.5 ง)) ค่าความเข้มของทั้งสองยอดพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ามาก ที่สุด (0°) แล้วจึงลดลงตามค่ามุมที่เพิ่มขึ้น จนลดลงมากที่สุดเมื่อปรับมุมได้ 90° จากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มขึ้น อีกจนมีค่าใกล้เคียงกับค่ามากที่สุดที่มุม 180 ° จากค่าความเข้มที่แตกต่างกันตามค่ามุมโพลาไรซ์ที่ เปลี่ยนไป สามารถใช้ในการหาค่า Degree of Polarization (DOP) ได้ดังความสัมพันธ์

$$DOP = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$
(4.2)

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27.23% และ 22.05% สำหรับยอดพลังงานที่ I และ II ตามลำดับ

แสงโพลาไรซ์จากยอดพลังงานที่ I และยอดพลังงานที่ II เกิดจากความไม่เท่ากันของค่ายกกำลัง สองของขนาดเวกเตอร์คลื่น (wave vector) ในทิศทาง [110] และ [1-10] $(k_{[110]}^2, k_{[1-10]}^2)$ ซึ่งขึ้นอยู่ กับปริมาณของควอนตัมดอตที่เรียงตัวในสองทิศทาง โดยยิ่งมีความแตกต่างมากถ้าควอนตัมดอตเรียงตัว โดดเด่นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง [96] ค่า DOP เป็นตัววัดตัวหนึ่งที่บอกถึงความแตกต่างดังกล่าว ค่า DOP ของทั้งสองยอดพลังงานมีค่าใกล้เคียงกันแสดงถึงการเรียงตัวที่ไม่แตกต่างกันมากนักของกลุ่ม ควอนตัมดอตทั้งสอง ผลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับลักษณะการเรียงตัวควอนตัมดอตของชิ้นงาน



รูปที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่า<mark>งค่าความเข้มกับมุม</mark>โพลาไรส์ของยอดพลังงานทั้งสี่ที่ปรากฏใน



บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

ควอนตัมดอตที่เกิดขึ้นแบบประกอบตนเองบนแผ่นฐานเรียบมีปัญหาด้านความเป็นระเบียบ เนื่องจากกระบวนการก่อตัว (SK) เป็นแบบสุ่ม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ออกแบบโครงสร้างที่สามารถลด ความสุ่มของตำแหน่งการเกิดของ InAs ควอนตัมดอตในการเกิดแบบประกอบตนเองด้วยการปรับปรุง แผ่นฐานเสมือนลายตาราง InGaAs/GaAsที่ถูกนำไปปลูกชั้นควอนตัมดอตโดยตรง [77] ด้วยการกลบ ทับด้วยชั้น GaAs spacer ก่อนที่จะปลูกควอนตัมดอต หลังการปลูก ชิ้นงานถูกนำไปวัดความสูงต่ำของ พื้นผิวด้วยเทคนิค AFM และวัดสมบัติทางแสงด้วยเทคนิค PL

ผลการวัดพื้นผิวในการทดลองพบว่า การปรับปรุงชั้นแผ่นฐานเสมือนลายตารางเดิมคือ In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ด้วยชั้น GaAs spacer ที่มีความหนาต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้า ใหม่เป็นแนวเนินยาวและกว้างมากขึ้นในทิศ [110] และทิศ [1-10] เมื่อเทียบกับ In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs เดิมซึ่งเป็นแนวของเนินยาวขนาดเล็ก ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจากแนวของ dislocation ที่เกิดขึ้นในชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs เปลี่ยนไปเมื่อมีชั้น GaAs spacer เพิ่มขึ้นบนผิวหน้า [56] โดยความกว้างของแนว เนินจะแปรผันตามขนาดของความหนาของชั้น GaAs spacer

การปลูกควอนตัมดอตลงบนผิวหน้าใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มชั้น GaAs spacer ก่อให้เกิดการ จัดเรียงควอนตัมดอตที่โดดเด่นในทิศ [110] มากกว่าในทิศ [1-10] แต่การปรับเปลี่ยนเทคนิคควอนตัม ดอตจากเดิมที่เป็นแบบ SK ทั่วไป ไปเป็น MEE SK ทำให้ควอนตัมดอตสามารถเปลี่ยนทิศทางการ จัดเรียงโดดเด่นไปยังทิศทาง [1-10] ได้ เนื่องจาก In adatoms มีอิสระในการเคลื่อนที่มากกว่า เพราะถูก รบกวนด้วยไอของ As₄ น้อยกว่า จึงเลือกก่อตัวในบริเวณที่ชื่นชอบ คือ ในทิศ [1-10] ซึ่งเป็นพื้นผิวที่มี ความลึก ความขรุขระ มากกว่า อีกทั้งยังมีผลของระนาบที่เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นผิวที่เป็นรอนคลื่นซึ่ง ส่งผลต่อการเลือกก่อตัวของควอนตัมดอตเช่นกัน

ผลการทดลองวัดสมบัติทางแสงด้วยเทคนิค PL แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานเปล่งแสงได้ดีตามผลที่ คาดหวังเนื่องจาก dislocation ที่ลดลง การเปล่งแสงยังแสดงให้เห็นถึงควอนตัมดอตสองกลุ่มในชิ้นงาน ซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกัน การเพิ่มกำลังแสงเลเซอร์กระตุ้นส่งผลให้ความเข้มของยอดพลังงานต่างๆมีค่า สูงขึ้นอันเป็นผลจาก state-filling effect [82] การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่งผลต่อการเปล่งแสงเป็น 2 ช่วง คือในช่วงแรกเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ความเข้มแสงในแต่ละยอดพลังงานเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเกิดการการเลื่อน ตำแหน่งของยอดพลังงานไปค่าพลังงานที่สูงขึ้น (blue shift) ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากพาหะได้รับ พลังงานเพิ่มขึ้นจากความร้อนจึงส่งผลคล้าย state-filling effect ในช่วงที่สองเมื่อเพิ่มอุณหภูมืสูงขึ้นอีก ปรากฏให้เห็น การลดลงของความเข้มแสงของยอดพลังงานโดยรวม และการเลื่อนตำแหน่งของยอด พลังงานต่างๆไปยังตำแหน่งที่พลังงานลดลง (red shift) ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจาก thermal excitation ที่มีสูงมากไปจนทำให้พาหะหลุดออก และการเกิด thermal expansion รวมถึง phonon scattering ขึ้น [92] ตามลำดับ นอกจากนี้แสงจากควอนตัมดอตเป็นแสงโพลาไรซ์ อันเป็นผลจากการ เรียงตัวเป็นเส้นในทิศ [110] และ [1-10]

จากผลการทดลองทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า การเพิ่มชั้น GaAs Spacer ลงบนผิวหน้าลายตาราง In_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าขึ้น โดยสามารถใช้ผิวหน้าดังกล่าวในการ ก่อตัวและเรียงตัวของควอนตัมดอตที่เป็นระเบียบแบบเส้นยาวในทิศ [110] และทิศ [1-10] พร้อมกันนี้ยัง ได้การเปล่งแสงที่ดีไม่ด้อยไปกว่าควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐาน (100)-GaAs โดยตรงเนื่องจากลด ผลกระทบจาก dislocation ในชั้น In_{0.15}Ga_{0.85}As

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

- [1] Fedor mitschke, Fiber Optics Physics and technology, (2009)
- [2] Zaitsev, S.V., et el. Time-resolved photolumines-cence and carrier dynamics in vertically-coupled self-assembled Quantum Dots epitaxy (MBE). <u>Japanese Journal</u> <u>of Applied Physics 38</u>, (1999): 601.
- [3] Kroemer, H. "Semiconductor light-emitting diode and method for producing same" <u>US</u>
 <u>Patent 3958265</u>, May 18, (1976).
- [4] Rinaldi, F. Basics of Molecular Beam Epitaxy (MBE). <u>Annual Report (2002).</u> Optoelectronics Department. University of Ulm. Germany, 2002.
- [5] http://www.phys.ksu.edu/personal/mnakarmi/MOCVD/mocvd.html
- [6] John DiNardo, N. Nanoscale Chracterization of Surfaces and Interfaces, 1994.
- [7] Yao, N., and Wang, Z. <u>Handbook of Microscopy for Nanotechnology</u>, 2005.
- [8] Hannink, R.H.J., and Hill, A.J. <u>Nanostructure control of materials</u>, 2006.
- [9] Shimizu, H., Saravanan, S., Yoshida, Y., Ibe, S., and Yokouchi, N. InAs quantum dot lasers with extremely low threshold current density (7 A/cm²/Layer). <u>Journal of</u> <u>Applied Physics</u> 44 (2005) : L1103-L1104.
- [10] Chang, F.Y., Lee, J.D., and Lin, H.H. Low threshold current density 1.3 μm InAs/InGaAs quantum dot lasers with InGaP cladding layers grown by gas-source molecular-beam epitaxy. <u>Electronics Letters</u> Vol. 40 (2004) : 179-180
- [11] Kamins, T.I., and Stanley, R.W. Lithographic positioning of self-assembled Ge islands on Si (001). <u>Applied Physics Letter</u> 71(1997) : 1201-1203.
- [12] Ritz, M., Kaneko, T., and Eberl, K. The effect of surface reconstructions on the surface morphology during in situ etching of GaAs. <u>Applied Physics</u> <u>Letter</u> 71(1997) : 695-697
- [13] Placidi, E., Arciprete, F., Fanfoni, M., Patella, F., and Balzarotti, A. The InAs/GaAs (001) Quantum Dots Transition : Advances on Understanding, <u>Lecture Notes in</u> <u>Nanoscale Science and Technology, Self-Assembled Quantum Dots</u> (2007) : 1-23

- [14] Uccelli, E., Bauer, J., Bichler, M., Schuh, D., Finley, J. J., Abstreiter, G., and Fontcuberta i Morral, A. Self-assembly of InAs Quantum Dot Structures on Cleaved Facets. <u>Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology</u>, <u>Self-Assembled</u> <u>Quantum Dots</u> (2007) : 24-41
- [15] Pohl, U.W. InAs/GaAs Quantum Dots with Multimodal Size Distribution. <u>Lecture Notes</u> in Nanoscale Science and Technology, Self-Assembled Quantum Dots,(2007) : 43-66
- [16] Eaglesham, D.J., and Cerullo, M. Dislocation-free Stranski-Krastanow growth of Ge on Si(100). <u>Physics Review Letter</u> 64 (1990) : 1943-1946.
- [17] Flack, F., Samarth, N., Nikitin, V., Crowell, P. A., Shi, J., Levy, J., and Awschalom,
 D.D. Near-field optical spectroscopy of localized excitons in strained CdSe quantum dots. <u>Physics Review B</u> 54 (1996) : R17312-R17315.
- [18] Xin, S.H., Wang, P.D., Yin, A., Kim, C., Dobrowolska, M., Merz, J.L., and Furdyna, J.K. Formation of self-assembling CdSe quantum dots on ZnSe by molecular beam epitaxy. <u>Applied Physics Letter</u> 69 (1996) : 3884-3886.
- [19] Kitamura, K., Umeya, H., Jia, A., Shimotomai, M., Kato, Y., Kobayashi, M., Yoshikawa, A., and Takahashi, K. Self-assembled CdS quantum-dot structures grown on ZnSe and ZnSSe, <u>Journal of Crystal Growth</u> 214 (2000) : 680-683.
- [20] Pinczolits, M., Springholz, G., and Bauer, G. Direct formation of self-assembled quantum dots under tensile strain by heteroepitaxy of PbSe on PbTe(III). <u>Applied</u> <u>Physics Letter</u> 73 (1998) : 250-252.
- [21] Bressler-Hill, V., Varma, S., Lorke, A., Nosho, B.Z., Petroff, P.M., and Weinberg, W.H.
 Island scaling in strained heteroepitaxy: InAs/GaAs (001). <u>Physics Review Letter</u>.
 74 (1995) : 3209-3212.
- [22] Qianghua, X., Madhukar, A., Chen, P., and Kobayashi, N.P. Vertically self-organized InAs quantum box islands on GaAs (100). <u>Physics Review Letter</u> 75 (1995): 2542-2545.

- [23] Leon, R., Fafard, S., Leonard, D., Merz, J.L., and Petroff, P.M. Visible luminescence from semiconductor quantum dots in large ensembles. <u>Applied Physics Letter</u> 67 (1995) :521-523.
- [24] Ramvall, P., Tanaka, S., Nomura, S., Riblet, P., and Aoyagi, Y. Confinement induced decrease of the exciton-longitudinal optical phonon coupling in GaN quantum dots. <u>Applied Physics Letter</u> 75 (1999) :1935-1937.
- [25] Damilano, B., Grandjean, N., Semond, F., Massies, J., and Leroux, M., From visible to white light emission by GaN quantum dots on Si(III) substrate. <u>Applied Physics</u> <u>Letter</u> 75 (1999) 962-964.
- [26] Tachibana, K., Someya, T., Ishida, S., and Arakawa, Y. Selective growth of InGaN quantum dot structures and their microphotoluminescence at room temperature. <u>Applied Physics Letter</u> 76 (2000) : 3212-3214.
- [27] Zundel, M.K., Specht, A.P., Eberl, K., Jin-Phillip, N.Y., and Phillipp, F. Structural and optical properties of vertically aligned InP quantum dots. <u>Applied Physics Letter</u> 71 (1997): 2972-2974.
- [28] Hatami, F., et al. Radiative recombination in type-II GaSb/GaAs quantum dots, <u>Applied Physics Letter</u> 67 (1995): 656-658.
- [29] Wang, Z. M., Holmes, K., Mazur, Yu.I., and Salamo, G.J. Fabrication of (In,Ga)As quantum-dot chains on GaAs(100). <u>Applied Physics Letter</u> 84 (15 MARCH 2004) : 1931-1933.
- [30] Mano, T., Kuroda, T., Mitsuishi, K., Yamagiwa, M., Guo, X.J., Furaya, K., Sakada, K., and Koguchi, N. Ring-shaped GaAs quantum dot laser grown by droplet epitaxy : Effects of post-growth annealing on structural and optical properties. <u>Journal of Crystal Growth</u> 301 (2007) : 740-743.
- [31] Thet, C.C., Kanjanachuchai, S., and Panyakaew, S. Growth of InAs quantum-dot hatches on InGaAs/GaAs cross-hatch virtual substrates. <u>Microelectronic</u> <u>Engineering</u> 84 (2007) : 1562-1565

- [32]Zhang, C. L., Xu, B., Wang, Z. G., Jin, P., and Zhao, F.A. Development of crosshatch grid morphology and its effect on ordering growth of quantum dots. <u>Physica</u> <u>E</u> 25 (2004) : 592-596.
- [33] Thet, C.C. <u>Growth and Characterisation of Ordered InAs Quantum Dots on Cross-hatch Virtual Substrate</u>. Ph.D.'s thesis, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 2006.
- [34] Limwongse, T. Evolution Of InAs Quantum Dots Grown On Cross-hatch Substates.
 Master Degree's thesis, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 2006.
- [35] Vdovin, V.L. Natute and origin of pure edge dislocations in low mismatched epitaxial structure, <u>Journal of Crystal Growth</u> 172 (1997) : 58-63.
- [36] Hongland, R.G., Hirth, J.P., Misra, A., and Martin. D. Influence of surface step on glide of threading dislocations during layer growth. <u>Applied Physics Letter</u> 84 (2004) : 5136-5138.
- [37] Zeghbroeck, B.V. Principles of Semiconductor Devices. Colarado University, 2006.
- [38] Grundmann, M. <u>The Physics of semiconductors</u>. Spinger, 2006.
- [39] Reed, M. A., Randall, J.N., Aggarwal, R.J., Matyi, R.J., Moore, T.M., and Wetsel, A.E. Observation of discrete electronic states in a zero-dimensional semiconductor nanostructure. <u>Physics Review Letter</u> 60(1987): 535–537
- [40] Suraprapapich, S., Kanjanachuchai, S., Thainoi, S., and Panyakeow, S. Ordered quantum dots formation on engineered template by molecular beam epitaxy. <u>Microelectronic Engineering</u> 78-79 (2005) : 349-352
- [41] Herman, M. A., and Sitter, H. <u>Molecular Beam Epitaxy Fundamental and Current</u> <u>Status</u>. Springer-Verlag, Berlin, 1989.
- [42] Sears, K., Mokkapati, S., Tan, H.H., and Jagadish, C. In(Ga)As/GaAs Quantum Dots Grown by MOCVD for Opto-electronic Device Applications. <u>Lecture Notes in</u> <u>Nanoscale Science and Technology,Self-Assembled Quantum Dots</u>, (2007) : 359-404

- [43] Bansal, B. Gokhale, M.R., Bhattacharya, A., and Arora, B.M.Growth kinetics effects on self-assembled InAs/InP quantum dots, <u>Applied Physics Letter</u> 87 (2005) : 203104 - 203104
- [44] Yamaguchi, K., Saito, Y., and Ohtsubo, R., Size-shrinkage effect of InAs quantum dots during a GaAs capping growth. <u>Applied Surface Science</u> 190 (2002) : 212-217
- [45] Songmuang, R., Kiravittaya, S., and Schmidt. O.G. Shape evolution of InAs quantum dots during overgrowth. Journal of Crystal Growth 249 (2003) : 416-421
- [46] Kastner, M.A. The single electron transistor and artificial atoms, <u>Annaul Physics</u> (Leipzig) 9 (2000) : 885 – 894.
- [47] Snider, G., and et al. Quantum-dot cellular automata. <u>Papers of microprocesses and</u> <u>nanotechnology conference</u>, Yokohama, Japan (1999) : 90–91.
- [48] Kiravittaya, S., Heidemeyer, H., and Schmidt, O.G. In(Ga)As Quantum Dot Crystals on Patterned GaAs(001) Substrates. <u>Lateral Aligment of Epitaxial Quantum Dots</u> (2007) : 489-511
- [49] Qian, X. Li, J. Wasserman, D. Goodhue, W. D., Uniform InGaAs quantum dot arrays fabricated using nanosphere lithography. <u>Applied Physics Letter</u> 93, (2008) : 231907
- [50] Wang, Z.M., and Salamo, G.J. Towards Quantum Dot Crystals Via Multilayer Stacking on Different Indexed Surfaces, <u>Lateral Alignment of Epitaxy Quantum</u> <u>Dots</u> (2007) : 325-345.
- [51] Wang, Z.M., Holmes, K., Mazur, Yu.I., and Salamo, G.J., Fabrication of .In,Ga.As quantum-dot chains on GaAs(100), <u>Applied Physics Letter</u> 84 (2004) : 1931-1933
- [52] Bhattacharya, P., and et al. <u>Properties of Lattice matched and Strained Indium</u> <u>Gallium Arsenide</u>. INSPEC, London, 1993.
- [53] Chang, K.H., Gibala, R., and Srolovitz, D.J. Crosshatched surface morphology in strained III – V semiconductor films, <u>Japanese Journal of Applied Physics</u> 69 (2005): 4093-4098.

- [54] Tamura, M., Hashimoto, A., and Nakatsugawa, Y. Threading dislocations in In_xGa₁. xAs/GaAs heterostructure, <u>Japanese Journal of Applied Physics</u>, 72 (1992) : 3398-3405.
- [55] Romanov, A.E., Pompe, W., Mahtis, S., Beltz, G.E., and Speck, J.S. Threading Dislocation Reduction in Strained Layers. <u>Journal of Applied Physics</u> 85 (1999) : 182-192.
- [56] Andrews, A.M., Speck. J.S., Romanov, A.E., Bobeth, M., and Pompe. W. Modeling Crosshatch Surface Morphology in Growing Mismatched Layer. <u>Journal of Applied</u> <u>Physics</u> 91 (2002) : 1933-1943.
- [57] Andrews, A. M., Lesar, R., Kerner, M.A., and Speck, J.S. Modeling Crosshatch Surface Morphology in Growing Mismatched Layer Part II: Periodic boundary conditions and dislocation groups. <u>Journal of Applied Physics</u> 95 (2004) : 6032-6047.
- [58] Wu, J., Li, W., Fan, T.W., and Wang, Z.G. Breaking up of misfit dislocations in GaAs/In0.3Ga0.7As/GaAs heterostructure, <u>Applied Physics Letter</u> 67, (1995) : 846-847.
- [59] Wang, S.M., Thordson, J.V., Anderson, T.G., Jian, S., Yang, L.X., and Shen, S.C. Influence of cap layer thickness on optical quality in In_{0.2}Ga_{0.8}As/GaAs single quantum wells. <u>Applied Physics Letter</u> 65 (1994) : 336
- [60] Kim, K.M., Park, Y.J., Park, Y.M., and Hyon, C.K. Alignment of InAs quantum dots on a controllable strain-relaxed substrate using an InAs/GaAs superlattice. <u>Journal of</u> <u>Applied Physics</u> 92 (2002) : 5453-5456
- [61] Voigtländer, B. Formation of Two-Dimensional Si/Ge Nanostructures Observed by STM, <u>Quantum Dots: Fundamentals, Applications, and Frontiers</u> 190 (2005) : 43-54
- [62] http://en.wikipedia.org/wiki/Turbomolecular_pump
- [63] http://www.mbe-komponenten.de/products/manipulation/sh-o.html
- [64] http://www.tectra.de/k-cell.htm
- [65] http://en.wikipedia.org/wiki/Hot_filament_ionization_gauge
- [66] http://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_high_energy_electron_diffraction

- [67] http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_mass_analyzer
- [68] http://www.stev.gb.com/science/spectroscopy.html
- [69] Thudsalingkarnsakul, N., Effective One-Dimensional Electronics Structure Of InGaAs Quantum Dot molecules. Master Degree's thesis, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 2008.
- [70] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic_force_microscope_block_diagram_ v2.svg
- [71] Franchi, S., Trevisi, G., Seravalli, L., and Frigeri, P. Quantum dot nanostructures and molecular beam epitaxy. <u>Progress in Crystal Growth and Characterization of</u> <u>Materials</u> 47 (2003) : 166-195.
- [72] http://comp.uark.edu/~jchakhal/REED.htm
- [73] Franke, T., Kreutzer, P., Zacher, Th., Naumann, W., and Anton, R. In situ RHEED, AFM, and REM investigations of the surface recovery of MBE grown GaAs (0 0 1)layers during growth interruptions. Journal of Crystal Growth 193 (1998) : 451-459.
- [74] Daruka, I., and Barabasi, A.L. Dislocation-free island formation in heteroepitaxial growth: A study at equilibrium. <u>Physical Review Letters</u> 79 (1997) : 3708-3711.
- [75] Lee, J.W., Schuh, D., Bichler, M., and Abstreiter, G. Advanced Study of Various Characteristics Found in RHEED Patterns During The Growth of InAs Quantum Dots on GaAs (001) Substrate by Molecular Beam Epitaxy. <u>Applied Surface</u> <u>Science</u> 228 (2004) : 306-312.
- [76] Suraprapapich, S., Thainoi, S., Kanjanachuchai, S., and Panyakeow, S. Self-Assembled Quantum Dot Molecules by Molecular-Beam Epitaxy. <u>Journal of</u> <u>Vacuum Science Technology B</u> 23 (2005) : 1217-1220.
- [77] Kiravittaya, S., Nakamura, Y., Schmidt, O.G. Photoluminescence linewidth narrowing of InAs/GaAs self-assembled quantum dots. <u>Physica E</u> 2002; 13: 224-228.
- [78] Wang, S.M., and et al. Localized formation of InAs quantum dots on shallowpatterned GaAs(100). <u>Applied Physics Letters</u> 88 (2006): 233102(1)-233102(3).

- [79] Kiravittaya, S., <u>Homogeneity Improvement of InGaAs/GaAs Self-assembled Quantum</u> <u>Dots Grown by Molecular Beam Epitaxy</u>. Ph.D.'s thesis, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 2002.
- [80] Thet, C.C., Panyakeow, S., and Kanjanachuchai, S. Growth of InAs quantum-dot hatches on InGaAs/GaAs cross-hatch virtual substrates, <u>Microelectronic</u> <u>Engineering</u> 84 (2007) : 1562–1565.
- [81] Kanjanachuchai, S., Maitreeboriraks, M., Thet, C.C., Limwongse, T., and Panyakeow, S. Self-assembled InAs quantum dots on cross-hatch InGaAs templates: Excess growth, growth rate, capping and preferential alignment. <u>Microelectronic Engineering</u> 86 (2009) : 844–849.
- [82] Songmaung, R. Study on growth and In-situ processing of InAs self-oragnized <u>quantum dots for long wavelength application</u>. Ph.D.'s thesis, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 2003.
- [83] Lee, S.J., Lee, J.I., Kim, M.D., and Noh, S.K. Photoluminescence study of InAs quantum dots with a bimodal size distribution. <u>Journal of the Korean Physical</u> <u>Society</u> 42 (May 2003): 686-690.
- [84] Krishna, S., Zhu, D., Xu, J., Linder, K.K., Qasaimeh, O., Bhattacharya, P., and Huffaker, D.L. Structural and luminescence characteristics of cycled submonolayer InAs/GaAs quantum dots with room-temperature emission at 1.3 µm. Journal of <u>Applied Physics 86</u> (1999) 6135-6138.
- [85] Chit Swe, N.T., ., <u>Optical polarization property of laterally aligned quantum dots</u>. Ph.D.'s thesis, Department of Electrical Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University, 2007
- [86] Gérard, J.M., Génin, J.B., Lefebvre, J., Moison, J.M., Lebouché, N., and Barthe, F. Optical investigation of the self-organized growth of InAs/GaAs quantum boxes. <u>Journal Of Crystal Growth</u> 150 (1995) : 351-356.

- [87] Heitz, R., Ramachandran, T.R., Kalburge, A., Xie, Q., Mukhametzhanov, I., Chen, P., and Madhukar, A. Observation of Reentrant 2D to 3D Morphology Transition in Highly Strained Epitaxy: InAs on GaAs. <u>Physics Review Letters</u> 78 (1997) : 4071-4074.
- [88] Duarte, C.A., and et al. Influence of the temperature on the carrier capture into selfassembled InAs/GaAs quantum dots. <u>Journal Of Applied Physics</u> 93 (2003) : 6279.
- [89] Sun, X., Liu, J., Kimerling, L.C., and Michel, J. Direct gap photoluminescence of ntype tensile-strained Ge-on-Si. <u>Applied Physics Letters</u> 95 (2009) : 011911(1)-011911(2)
- [90] Wohlert, D.E., Chou, S.T., Chen, A.C., Cheng, K.Y., and Hsieh, K.C. Observation of temperature-insensitive emission wavelength in GaInAs strained multiplequantum-wire heterostructures. <u>Applied Physics Letters 68</u> (1996) : 2386-2388.
- [91] Miyake, Y., Hirayama, H., Kudo, K., and Tamura, S. Room-temperature operation of GaInAs/GaInAsP/InP SCH lasers with quantum-wire size active region. <u>IEEE</u> <u>Journal of Quantum Electronics 29</u> (1993) : 2123-2133.
- [92] Gammon, D., Rudin S., Reincke, T.L., Katzer, D.S., and Kyono, C.S. Phonon broadening of excitons in GaAs/AlxGa1-xAs quantum wells. <u>Physical Review B 51</u> (1995) : 16785-16789.
- [93] Varshni, Y.P. Temperature dependence of the energy gap in semiconductors. <u>Physica 34</u> (1967) : 149-154.
- [94] Jeon, S.M., and et al. Influence of InAs Coverage on Transition of Size Distribution and Optical Properties of InAs Quantum Dots. <u>ACTA Physica Polonica A</u> 118 (2010): 673-676.
- [95] Lu, X., Vaillancourt, J., and Wen, H. Temperature-dependent energy gap variation in InAs/GaAs quantum dots. <u>Applied Physics Letters</u> 96 (2010) : 173105.
- [96] Leon, R., Kim, Y., Jagadish, C., Gal, M., Zou, J., and Cockayne, D.J.H. Effects of interdiffusion on the luminescence of InGaAs/GaAs quantum dots. <u>Applied Physics</u> <u>Letters</u> 69 (1996) : 1888.

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายมตินนท์ ไมตรีบริรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 211/46 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2545 และจบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549



ศูนยวิทยทริพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย